

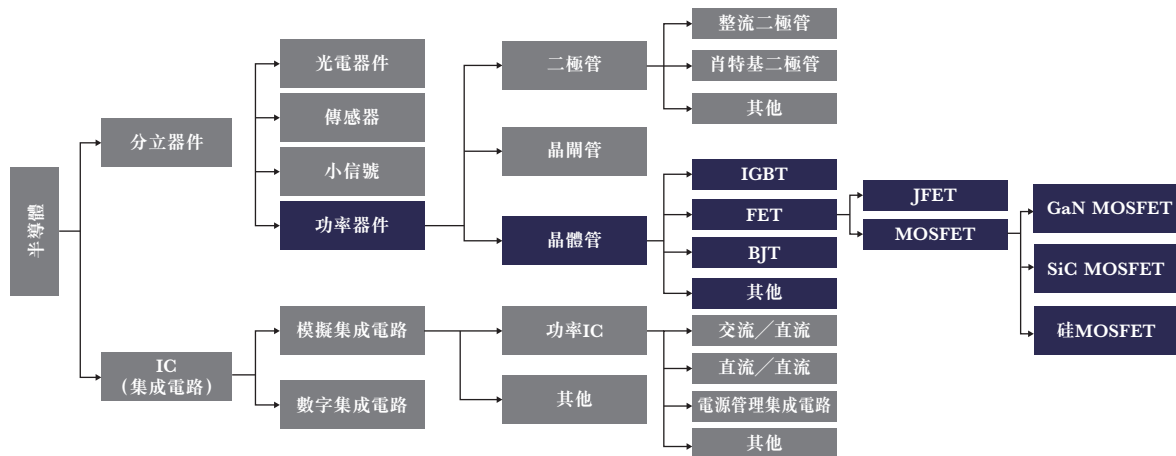
業 務

概覽

我們是一家無晶圓廠功率半導體供應商，專門從事定製化功率器件產品的開發及供應。我們為客戶量身定製技術應用解決方案，提供定製的功率器件，用於安裝在終端用戶最終使用的電氣設備及電氣產品的電路板上，旨在實現特定性能或優化該等產品的功能。我們於往績記錄期間提供的產品主要是MOSFET，其次是IGBT、GaN MOSFET及SiC MOSFET，該等產品主要由我們的技術專家設計、定製及／或開發，專門按照客戶要求量身定製，用於其下游產品。通過開發定製解決方案，我們希望發展及鞏固我們的行業地位，成為在細分領域為客戶提供高效及最佳解決方案的專家。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們分別售出超過270.5百萬件、203.2百萬件、251.3百萬件、168.4百萬件及279.4百萬件產品。

我們提供的產品用途廣泛，包括電源轉換器和電池管理系統。應用範圍涵蓋消費電子、工業控制、汽車電子、新能源及儲能、醫療設備等應用場景，廣泛用於掃地機器人、手持電動工具、無人機、各種消費電子適配器、LED照明、戶外儲能等應用產品。該廣泛適用性可增強我們的增長潛力，使我們能夠開拓多樣化的市場，適應不斷變化的行業趨勢。

功率半導體概覽



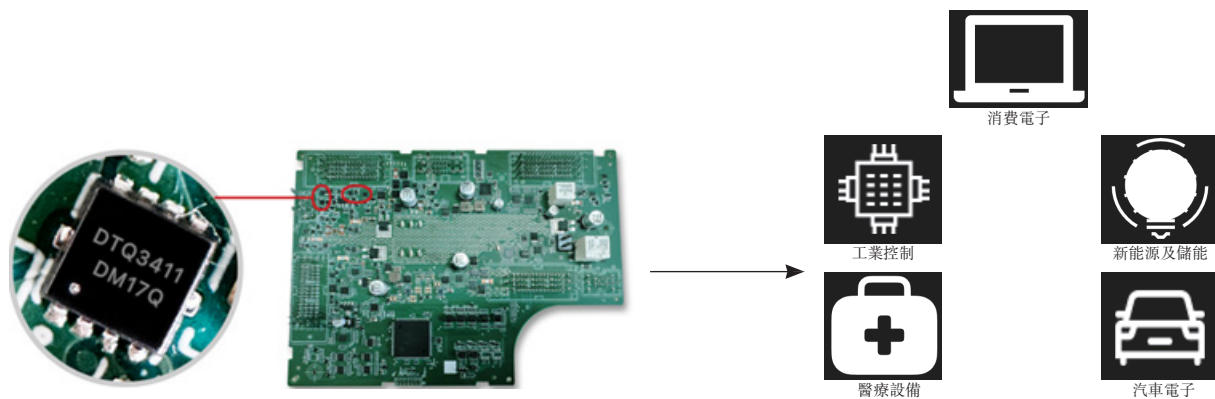
附註：功率半導體是廣義半導體系列中的一個專門類別，其設計目的為處理較高的功率層級，並確保在各類應用中進行有效的能源管理。功率半導體的主要類型包括功率器件(二極管、晶閘管及晶體管)及功率IC。

功率半導體是電子設備中功率轉換及電路控制的核心。從本質上講，通過利用半導體的單向導電性實現功率開關及功率轉換的功能，功率半導體可提高能量轉換效率，減少功率損耗，從而在應用產品使用過程中節約電力，提高電子產品的能效。

業 務

功率半導體是一種用於電路中的電力轉換和電力控制的裝置。功率半導體通常具有兩種功能，即作為開關開啟或關閉電信號，以及以較小電流或電壓控制較大電流的放大器。該等功能使功率半導體能夠自動和遠端開關電路，並將微弱的電信號放大為更大和更強大的電信號，以提高其所控制裝置的能效，並使需要較大電流的裝置能夠運作等等。功率半導體是半導體的重要元件，其性能會受到裝置中集成的晶體管數量的影響。具體而言，晶體管在稱為封裝的過程中被排列並裝入保護殼中，封裝的功能是保護晶體管的內部結構不受外部環境的物理傷害，以及方便晶體管與更廣泛的電路進行連接和集成。

晶體管，屬於功率器件的子類，根據其結構和功能可分為幾種類型，即FET、IGBT及BJT。由於FET主要利用電壓控制、切換和放大電流，因此不會從電路的其他部分吸取電流，能更有效率地將盡可能多的電流留給其他電路功能。此外，MOSFET是FET的一個子類，是以快速切換速度和高效率著稱的電壓控制裝置，特別是在低電壓和高頻率的應用中。IGBT同樣利用電壓來控制、切換和放大電流，但能夠處理比MOSFET更高的電壓和電流，因此用於高功率應用。



電路板上的MOSFET

常見應用領域

業 務

根據益普索的資料，MOSFET是電力電子中的重要組件。MOSFET的工作原理是利用電壓控制電流流動，以其快速的開關速度及高效率而著稱，特別是在較低電壓及較高頻率應用中。鑒於MOSFET的效率及多功能性，其在各種需要高效率、可靠性及性能的行業中發揮著至關重要的作用，包括汽車行業、可再生能源、消費電子及工業領域。另一方面，IGBT是在處理高壓及大電流應用方面(尤其是在600伏或以上的直流電壓)具有高效率及多功能性的晶體管。因此，IGBT在新能源汽車及風力發電中發揮著重要作用，並為高壓軌道交通、智能電網及工業電機提供必要的功率密度、高可靠性及良好的散熱性能。

根據益普索的資料，MOSFET及IGBT製造價值鏈可分為上游、中游和下游三個分部。上游分部涉及採購MOSFET和IGBT生產所需的原材料和基本元件及製造設備。營運模式分為兩種：一種是集成器件製造商(IDM)，包含從晶片設計、晶圓製造、封裝、測試到銷售的垂直整合；另一種是無晶圓廠公司(fabless companies)，專注於設計，並將晶圓製造和封裝／測試外包給外部加工商。在IDM模式下，垂直集成公司參與所有三個製造階段，從而提升所有製造階段的協調效率。然而，IDM屬於重資產且資本支出較高。在無晶圓廠模式下，無晶圓廠公司主要負責晶片設計，而將製造和封裝測試階段外包給相應的晶圓代工廠和OSAT公司。因此，彼等在資本運用上更具彈性，並能快速回應市場需求。下游分部包括經銷商、系統製造商和終端用戶。分銷商通常負責分銷中游分部的公司所生產的一系列MOSFET和IGBT產品，並為系統製造商提供一站式供應解決方案，亦提供售後服務和產品管理支持等額外福利。系統製造商是半導體產品的需求方，彼等會採購半導體產品以整合到各自的產品中，最終讓終端使用者從使用這些產品的價值中獲益。

作為無晶圓廠供應商，我們的運營模式使我們能夠專注於產品設計及開發，同時將製造流程外包予專業代工廠及封裝廠。我們的主要目標是增強我們的產品設計能力並提升我們的產品技術水平。通過外包晶圓製造、封裝及測試，我們可專注於產品設計及開發方面的核心競爭力，確保交付優質產品，而不會產生與維護製造設施相關的開支。

我們重視直銷並與客戶保持密切關係。我們十分重視了解及滿足彼等對產品技術及性能可靠性的需求。該種以客戶為中心的方法推動我們的產品開發過程，使我們能夠量身定製產品來滿足特定的市場需求及挑戰。我們的研發部門不斷與客戶協同合作以收集見解，確保我們的產品一直具有競爭力。

業 務

為有效管理我們與供應商的關係，我們已建立全面的供應商外包管理體系。該體系監督及協調我們與代工廠及封裝廠的合作關係。通過實施一系列質量控制措施及供應商評估，我們確保所收到的產品始終符合我們的高質量及性能標準。通過該戰略方法，本公司具備創新發展優勢，最終提供產品，提高客戶滿意度並促進長期增長。

市場機遇

中國市場

MOSFET製造業為技術密集型行業，需要較高的整體專業技術水平。根據益普索的資料，隨著先進技術在下游產業的創新應用，MOSFET製造業的技術水平不斷進步，包括採用第三代半導體材料(如SiC與GaN)的MOSFET產品。與傳統的硅基材料相比，其具有更高的效率、更快的開關速度以及更高的熱穩定性。由於MOSFET廣泛應用於消費電子、汽車應用和可再生能源系統，因此對其需求大幅增長，隨著更多行業因其在電源管理方面的優異性能而採用MOSFET，其用途預計將繼續擴大。中國MOSFET市場於2019年至2023年按複合年增長率13.9%增長，預計之後於2024年至2029年按複合年增長率6.0%擴大。

此外，芯片設計是MOSFET產業鏈中對研發能力要求較高的關鍵環節。根據益普索的資料，在下游需求快速增長的情況下，具有較強研發能力的國內公司可逐步追上國際主流MOSFET製造商，保持市場競爭力，進一步搶佔可觀的市場份額。由於MOSFET製造發源於歐美，日韓緊隨其後，已具有自身的競爭力，因此國際領先的半導體製造商長期以來一直主導著國內MOSFET的高端應用市場。然而，由於該等製造商的產品價格高昂，無法滿足快速增長的國內市場需求，該發展趨勢導致了中國的供需失衡。為扶持中國國內半導體行業，推動半導體「中國製造」的政策目標，中國政府不斷出台各種鼓勵政策，包括：《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》，為半導體分立器件(包括MOSFET和IGBT)的發展提供政策保障和明確的發展方向；《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》等額外政策，MOSFET與IGBT一併被列為優先發展項目；以及《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，提出了關於降低稅費、加大金融支持力度、建立產業研發技術體系等措施，以促進MOSFET發展。該等政府政策和支持將有助於我們加快MOSFET和IGBT產品的研發進度，同時降低研發成本和財務負擔。

業 務

隨著中國功率半導體市場參與者突破高端產品技術瓶頸，預計中國對進口MOSFET產品的依賴程度將會降低。該等發展將為包括本公司業務在內的中國國內MOSFET製造業參與者帶來巨大的市場機遇。

東南亞及南亞市場

根據益普索的資料，在東南亞，東南亞國家聯盟(東盟國家)在全球貿易中的重要性近年來穩步增長，從2018年至2022年，其在全球出口中所佔的比例由約6.8%增至7.6%。此增長是由於中國面臨成本上升、貿易局勢緊張和地緣政治風險的影響，而東盟國家擁有較低的勞動力成本、不斷擴充的勞動力、戰略位置、有利的政府獎勵措施、製造能力的提升(尤其是在電子及數碼領域)，導致製造工序從中國轉移至東盟國家(如馬來西亞、越南和泰國等)。東盟國家可提供龐大的勞動力，其中年輕且技術日趨嫻熟的勞動力佔全球第三位，彼等可按比中國更低的工資擔任製造業職位，有助擬於當地開展業務的製造商提高成本效益。此外，鑑於東盟國家與中國、日本、南韓和澳大利亞等主要市場的戰略位置，及其不斷完善的運輸與物流網絡及系統可滿足製造能力，均有助製造商輕鬆進入市場以及實現供應鏈多樣化。此外，東盟各國政府提供企業稅務減免、簡化法規，並設立了企業投資優惠制度。東南亞的主要電子產業包括汽車、電動車與電池、家電與其他消費類電子產品、照明、電源供應、醫療、工業與安全等，以及以合約製造為主的經濟環節，包括為無晶圓廠公司提供電子元件或產品的第三方製造商。

根據益普索的資料，在南亞地區，印度近年來對電子產品的需求大幅飆升，原因在於印度為全球第二大手機製造國，以及其網絡普及率的飆升。印度電子系統設計與製造(ESDM)市場是印度政府於2025年前打造1兆美元數字經濟目標的重要組成部分。印度政府高度重視電子硬件製造業，透過實施各種政策措施，包括「印度製造」、「數字印度」和「創業印度」計劃，促進其國內製造業和ESDM創新，使印度電子產品(如手機和其他消費類電子產品)的生產和組裝活動不斷增長。其他因素包括不斷擴大的終端用戶基礎、前景看好的新創企業生態系統、強有力的政策支持，以及不斷增加的外商直接投資，均推動印度的ESDM產業。於最後實際可行日期，我們已開始與印度的新客戶進行首批業務交易。

業 務

因此，電子產業和製造業不斷增長的需求，以及東南亞和南亞市場內獨特的區域優勢和對製造業務的支持，為中國以外地區提供功率半導體帶來了可觀的成長機會。

競爭優勢

利用我們在定製化及以客戶為中心的售後服務上的競爭優勢

本公司的競爭優勢在於戰略性地採用直銷方式，同時高度重視定製的產品解決方案。我們與客戶建立密切的關係，便於更加個性化的互動及對客戶需求的更深入理解。該直接接觸使我們的銷售及營銷部門能夠與技術產品及研發部門合作，直接參與客戶產品的開發及提供滿足客戶期望的定製產品，從而提升客戶滿意度及忠誠度。此外，我們向客戶提供以客戶為中心的售後技術支持服務，服務時間並無明確限制，以確保客戶有關我們產品的問詢及問題在產品交付後得到及時和徹底的解決。因此，我們能夠加強與客戶的持續關係並強化客戶的品牌記憶，最終有助於提高客戶對我們品牌的忠誠度。有關客戶忠誠度的詳情，請參閱本節「競爭優勢 – 多元化的龐大客戶群」。此外，我們專業的售後服務進一步與我們的直銷方式產生協同效應，為我們提供了一個額外的途徑，供我們不斷更新及建立對客戶的資料及了解，從而更好地滿足客戶的特定需求。

我們的與眾不同之處在於我們有能力根據客戶的具體要求定製產品設計。該靈活性使我們能夠滿足多樣化的應用範圍，使我們的產品在不同行業中對客戶更具相關性及適用性。我們資深的銷售及營銷部門於此過程中發揮著關鍵作用。憑藉彼等的專業知識及行業知識，我們可以迅速調整產品，靈活應對市場需求及技術進步。

此外，我們的直銷模式使客戶獲得更優惠的價格，因此我們較競爭對手具有價格優勢。並無中間商參與的情況下，本集團可享有較高的利潤率，因為無需向中間商攤分利潤率。該銷售模式使我們的產品更加易於獲取，並鞏固了我們的市場競爭地位。

業 務

定製的產品解決方案、直銷及售後服務三軌並舉，結合我們的研發能力及無晶圓廠業務模式，為我們的運營提供寶貴的協同效應。一方面，我們的直銷方式是獲取重要市場情報的直接渠道，通過我們與客戶的直接接觸及互動，了解最新客戶需求、態度及偏好，使我們能夠了解市場的實時發展及其在當地的實際應用，而以客戶為中心的售後服務允許我們不斷更新該知識並將其應用於我們產品中。這一關鍵競爭優勢與我們的研發能力及產品解決方案相輔相成，通過引導我們的研發計劃及產品定製解決方案的的方向，解決最相關的技術和實際問題。我們的無晶圓廠業務模式亦使我們能夠將時間及資源主要用於實行有關研發計劃及定製方法，從而提高我們在該等領域的速度及效率。

此外，滿意的客戶往往會成為品牌擁躉，從而帶來寶貴的推介及不斷擴大的客戶群。因此，我們準備就緒把握半導體行業的新興機會，同時鞏固我們作為可信賴創新合作夥伴的地位。

多元化的龐大客戶群

本公司的競爭優勢得益於我們廣泛且多元化的客戶群，涵蓋各行各業的超過500名客戶。於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們分別自385名、389名、402名及384名客戶錄得收入。該廣泛的客戶範圍涵蓋智能家電、消費電子、電力驅動、新能源及儲能、工業驅動、汽車電子及其他場景等領域，展示了我們產品的多功能性及適應性。我們產品的廣泛適用性使我們能夠滿足多種應用需求，使我們的產品對眾多業務具有相關性及價值。

我們客戶群的多元化不僅增強了我們的市場覆蓋範圍，亦使我們更有潛力利用各行各業的增長機會。通過服務不同行業的客戶，我們能夠充分把握新興機遇及需求變化。該韌性對於確保我們能夠迅速適應市場格局的變化至關重要，使我們保持競爭優勢。

業 務

此外，我們龐大的客戶群為我們提供了對市場趨勢及客戶偏好的寶貴見解。該信息使我們能夠有效改進產品供應並創新，持續領先於競爭對手。另外，由於滿意的客戶通常會於其關係網中分享彼等的積極體驗，因此更龐大的客戶群意味著更高的推介潛力。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們歸屬於新客戶的收入分別約為人民幣21.3百萬元、人民幣7.1百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣4.0百萬元，分別約佔同期收入的12.7%、6.3%、6.3%及3.8%。我們與客戶建立的關係亦促進了忠誠度，從而帶來了重覆業務及推介，進一步擴大了我們的覆蓋面。舉例而言，於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們的客戶留存率(按緊接上一年度的客戶中於下一年度仍為我們客戶並貢獻收益的客戶數量除以緊接上一年度已為本集團貢獻收益的年初客戶總數所得百分比計算)分別約為68.3%、69.1%、71.5%及72.4%，同期分別留存198名、266名、278名及291名客戶。我們的客戶留存率由2024財年的71.5%增至截至2025年9月30日止九個月的72.4%，主要是由於部分客戶在與我們完成產品測試後增加後續訂單。截至2022年、2023年及2024年12月31日以及截至2025年9月30日止九個月，客戶與我們保持業務關係的平均年限分別為2.8年、3.0年、3.4年及3.2年。具體而言，這表示與我們維持較長時間業務關係的客戶對本集團收入的平均貢獻較新客戶為多，主要是由於彼等對我們產品及服務的質素及可靠性已建立信任。此外，於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們分別約有16名、21名、17名及22名新客戶是由現有客戶推介。通過利用多元化的客戶組合，我們有能力把握新興機遇並繼續在半導體行業的發展軌跡上前進。

	截至12月31日止年度			截至9月30日
	2022財年	2023財年	2024財年	止九個月 2025年
客戶數量(期初結餘)	290	385	389	402
增加 ¹	188	123	124	93
減少 ²	93	119	111	111
客戶數量(期末結餘)	385	389	402	384
客戶留存率	68.3%	69.1%	71.5%	72.4%

附註：

1. 增加指本年度有收入貢獻且有交易記錄，但上一年度並無收入貢獻及交易記錄的新客戶及保留客戶數量。
2. 減少指上一年度有收入貢獻但本年度並無收入貢獻的客戶數量。
3. 客戶留存率指上一年度的客戶中在本年度仍有收入貢獻的客戶所佔百分比。

業 務

於往績記錄期間，我們的客戶可能根據各客戶累積存貨的可用性及市場對其各自下游產品的需求，不定期地向我們發出採購訂單。因此，我們的客戶未必每年均向我們發出採購訂單，導致我們每年／期的客戶數目出現大幅變動。

擁有開拓進取精神及豐富經驗的管理團隊

我們的創始人劉先生旨在成為一位創新的遠見者，堅持不懈，投身創新。憑藉卓越的學術及行業經驗記錄，劉先生利用其遠見及對行業趨勢及客戶需求的了解，指導本公司的技術進步及產品定位。劉先生擁有超過20年的功率半導體行業經驗。劉先生於2005年6月獲得中山大學物理學學士學位，並於2020年12月獲得中山大學工商管理碩士學位。於劉先生的帶領下，我們的管理團隊平均擁有超過10年的企業管理、產品開發及營銷經驗。

於劉先生的領導下，我們設立一種優先直接接觸客戶的銷售及營銷戰略方法。該方法使我們能夠與客戶建立牢固的關係，並根據彼等的具體需求量身定製產品。部門成員的豐富經驗增強了我們提供明智見解及解決方案的能力，從而提高整體客戶滿意度。隨著我們的發展，我們的銷售及營銷部門將繼續專注於為客戶創造價值，同時適應不斷變化的市場格局。

我們的銷售及營銷部門由朱先生領導，彼於半導體行業擁有超過10年的銷售經驗。截至最後實際可行日期，我們的銷售及營銷部門由33名員工組成，其中核心銷售人員已在本公司工作超過五年。該穩定性不僅促進了工作環境的凝聚力，亦確保團隊成員對我們產品及半導體行業的深刻了解。

我們的研發部門是技術進步的核心，由劉鵬飛先生領導，彼於集成電路及半導體行業擁有豐富經驗。於其領導下，研發部門培養了創新卓越的文化，專注於開發滿足客戶不斷變化需求的定製產品。我們的戰略願景確保研發工作與市場趨勢及客戶需求緊密一致。通過優先與客戶直接接觸，我們的研發部門能夠收集寶貴的見解，為產品開發提供信息並提升我們的產品。該方法不僅鞏固了我們與客戶的關係，亦使我們能夠提供符合客戶期望的定製產品。於最後實際可行日期，我們有15項發明專利、5項實用新型、47項集成電路佈圖設計專有權、15項軟件版權及4項商標，這是我們發展的核心動力。

業 務

廣泛的供應商網絡

我們多年來精心建立廣泛的供應商網絡。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們分別有49名、60名、73名及73名供應商。該廣泛的網絡包括各類晶圓代工廠及封裝廠，確保我們供應鏈的穩定性。透過在行業內的沉澱，我們廣泛了解供應商的獨特技術和能力。對供應商的廣泛了解使我們能夠了解其各自的實力及優勢，並根據客戶需求物色合適的供應商。通過與該等專業供應商合作，我們可確保獲取合適的材料及技術，使我們的產品保持高標準的質量及性能。

擁有如此龐大的供應商網絡的關鍵優勢之一是我們能夠將晶圓的製造外包予滿足每位客戶特定技術規格的供應商，而技術規格取決於彼等的使用情況。該靈活性使我們能夠快速響應不同的客戶需求，並相應地調整我們對供應商的選擇。無論客戶對於電源供應的操作參數、產能、反應速度以及其他特殊需求是否有特定的要求，我們廣泛的網路都能讓我們找到合適的供應商，有效地滿足該等需求。

我們的供應商網絡不僅提高了我們物色理想供應商的能力，亦減少了與我們產品相關的交貨時間及成本。通過根據供應商的優勢及專業能力進行戰略性選擇，我們可優化供應鏈並確保及時向客戶交付優質產品。該靈活性於競爭激烈的市場中至關重要，客戶需求可能迅速變化，及時交付我們的產品對於保持客戶滿意度至關重要。

再者，我們與供應商的關係促進了合作及創新，使我們緊跟功率半導體行業的技術進步。通過與供應商密切合作，我們可了解新興趨勢及新材料，從而不斷改進我們的產品供應，以進一步鞏固我們在市場上的地位。

業務策略

通過對設備、技術及人才的戰略投資增強研發能力

除我們努力不懈開發我們核心MOSFET競爭力的研發能力外，我們認為第三代半導體(即SiC MOSFET與GaN MOSFET)的發展為功率器件市場帶來了新的機遇，這兩種材料與硅基半導體及IGBT相比具有更優異的性能特性，包括高功率密度、更快的開關速度和更佳的熱管理。此外，本公司擬加強開發更緊湊、更高效的設計，需要更創新的封裝技術，以進一步提升MOSFET和IGBT的多樣化應用、性能和可靠性以及擴大產品應用場景，是我們未來持續成功和發展的明確路徑。

業 務

我們計劃投資先進的設備及軟件來擴大我們的研發能力，我們亦計劃增聘具有適當教育程度、技術資格和功率半導體開發經驗的員工。這項措施旨在加強我們的整體研發流程，特別是深化我們在核心MOSFET產品開發方面的專業知識和能力，並探索開發對於醫療領域及汽車領域的高壓應用至關重要的IGBT產品。

設備方面，我們計劃購置先進的加工設備和模擬軟件，以改進我們的設計、開發及測試流程，重點關注業內功率半導體日益緊湊、複雜和高性能的發展趨勢。通過利用該等技術，我們的目標是建立一個強大的研發框架，促進我們產品線的創新。該項戰略投資將使我們能夠有效地應對產品設計的複雜性，確保我們的產品符合嚴謹的質量標準並符合行業規例。

增強研發能力方面，我們的重點是促進研發、技術產品、銷售及營銷部門之間的合作，以確保新技術與現有流程的無縫整合。通過在半導體技術方面建立堅實的基礎，我們可簡化工作流程，縮短產品上市時間，並提高對市場需求的響應能力。

我們致力於提高研發能力，從而滿足對功率半導體解決方案日益增長的需求。通過該戰略重點，我們計劃成為半導體市場的主要參與者，推動創新及提供卓越的產品，從而提高功率半導體的性能及可靠性，最終為功率半導體行業的進步作出貢獻。有關進一步增強我們在MOSFET和IGBT方面的研發能力的詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]」。

向海外市場進行戰略擴張

中國是全球領先的半導體出口國之一，對前十大目的地市場的出口額從2019年的約1,190億美元增至2023年的約1,593億美元，複合年增長率為約7.6%。中國半導體的主要出口目的國家和地區包括中國香港、韓國、新加坡、中國台北、印度、日本、越南、荷蘭、馬來西亞和巴西。我們的目標是在向國際市場擴展業務的過程中實現大幅增長，尤其是東南亞及南亞。我們的戰略目標是扎根半導體產品需求正在迅速增長的主要地區，特別是新加坡、馬來西亞、越南及印度。中國對新加坡、馬來西亞、越南及印度的半導體出口總值從2019年的約95億美元增加至2023年的約139億美元，年複合增長率約為9.9%。該擴張有助於我們成為半導體行業全球領導者，利用新興市場機遇推動收入及品牌認可。

業 務

在瞄準東南亞及南亞時，我們認識到獨特的市場動態及新興的半導體貿易商生態系統。與我們主要直接面向終端客戶的現有市場不同，我們的戰略將強調與該等地區的半導體貿易商建立穩固的合作夥伴關係。通過與知名分銷商及貿易公司合作，我們可有效駕馭當地市場格局，並利用現有網絡加快進入市場的步伐。該方法使我們能夠利用當地的專業知識及關係，促進更平穩的運營及更快的發展。

為支持此項策略性擴張，我們將在新加坡、馬來西亞、越南、印度等地發展及培養業務關係，以及宣傳及推廣我們的品牌及產品系列，方法是為我們的銷售及營銷部門僱員的營銷及業務發展計劃提供資金，包括主要用於海外旅遊及住宿、廣告及宣傳活動及業務招待的開支，以及支付委聘新加坡當地銷售代表在有關國家發掘及物色半導體市場的新商機，以供我們進一步磋商及參與。有關擴展東南亞及南亞市場的詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]」。

透過擴展東南亞及南亞市場，我們擬在迅速發展的半導體市場中建立地位。我們的目標不僅是增加我們的海外市場份額，同時也要打造我們在半導體貿易生態系統中的聲譽。

拓寬我們的客戶群及深化我們與客戶的關係

我們計劃吸引新客戶以擴大客戶群，深化我們於消費電子及工業控制領域的技術開發，並進一步拓展於新能源及儲能、汽車電子以及醫療設備領域的客戶基礎。同時，利用來自直銷方式獲取的信息及現有客戶的反饋，我們將擴大我們的功率半導體產品供應以及提高在醫療應用、機器人及人工智能應用等關鍵應用領域提供高性能產品的能力，此舉將有助於我們吸引優質客戶並提高客戶粘性。特別是，我們計劃深化與現有客戶的合作，並通過擴大銷售及營銷部門、參加行業展覽、加強品牌推廣、提供足夠的技術支持及售後服務以及與業內頂級市場參與者合作，吸引新客戶並與之建立長期業務關係。我們亦計劃提升銷售及營銷部門成員的能力，加強與其他部門的合作，以加深彼等對我們產品的了解，並引進經驗豐富的人才。

業 務

我們的業務模式

我們主要向客戶提供功率器件產品，專注於開發產品定製設計及向客戶提供定製化產品解決方案，同時將製造與封裝工藝外包予外部供應商。憑藉經驗豐富的研發部門及技術人員和高級管理層的技術專長，我們主要專注於設計及銷售符合國際公認標準的可靠性和穩定性的功率器件，尤其是MOSFET。憑藉我們的研發實力及對功率器件產品及其實際應用的廣泛技術知識，我們有效提升了產品設計效率，且能夠為客戶提供優質產品。此外，我們已註冊及正在註冊自主開發的知識產權，以保護我們的發明及設計不受第三方和未經授權的使用。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有15項專利、5項實用新型專利、47項集成電路佈圖設計專有權、15項軟件著作權及4項商標。這一廣泛的知識產權組合不僅增強我們的競爭優勢，亦是一項寶貴資產，可增強我們滿足客戶需求和推動半導體技術未來進步的能力。

我們的業務模式採用無晶圓廠方式運營，使我們能夠將資源集中於功率半導體產品的創新及設計，同時將製造及封裝外包予外部供應商。因半導體製造屬於資本密集行業，故無晶圓廠運營模式，不僅為我們減少資本支出，亦為我們提供快速適應不斷變化的市場需求及技術進步的靈活性。我們專注於設計及研發，使得我們可向研發及售後服務分配重要資源，推動我們產品供應的不斷創新，同時提高我們精準洞悉、量身定製合適解決方案的能力，並根據每個客戶的獨特需求和情況提供持續的售後支持。

無晶圓廠模式

我們採用無晶圓廠模式，專注於設計產品，同時將製造和封裝工藝外包給晶圓代工廠和封裝廠，並在製造的不同階段進行相關的產品測試。由於無晶圓廠公司不需要大量的資本投資和支出，因此功率半導體設計公司以無晶圓廠的模式營運可能更具成本效益。此外，根據益普索的資料，由於功率半導體設計處於製造產業價值鏈的核心位置，與MOSFET及其他功率器件產品製造產業價值鏈中的其他中游廠商相比，專門從事功率半導體設計(尤其是MOSFET及其他功率器件產品)的公司在過去三年中通常能獲得相對較高的平均毛利率。

業 務

此外，雖然我們為客戶提供功率器件產品，但我們促進銷售的業務方法主要是以服務為導向，以項目管理為中心。從與客戶約定開始，我們採取措施，通過與客戶團隊密切合作，了解彼等的具體需求、下游產品特性及期望的性能結果，隨後制定產品設計計劃並進行可行性研究，並在需要時利用我們的研發和跨職能資源，開發我們定製產品的原型進行測試，以確定投入生產的最佳組件、材料及參數。此外，我們管理選擇並與合適的第三方代工廠及封裝廠合作的整個過程，協調生產進度，並為生產過程提供質量規範和監督，以確保最終產品符合我們的標準並能滿足客戶的要求。我們亦提供全面的售後服務，包括諮詢服務及現場技術支持(如需要)，以解決客戶提出的問題。據董事所知，本集團出售的功率器件產品一般應用於本集團客戶的特定型號終端產品，而非在其產品組合中廣泛採用。因此，本集團各型號功率器件產品的訂購數量相對較低，並限於該等特定終端產品的生產規模。因此，本集團通常會接獲小批訂單，以緊貼客戶的生產計劃。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，本集團分別完成3,801份、5,548份、6,650份及5,583份採購訂單，每份訂單的平均採購金額分別為人民幣44,017元、人民幣20,377元、人民幣18,294元及人民幣18,837元。

請參閱本節「- 產品開發流程」。由於我們提供定製產品解決方案、項目管理和售後支持的全面服務，因此能夠於往績記錄期間實現較高的毛利率。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們的毛利率分別約為55.8%、55.0%、56.9%、56.7%及57.1%。請參閱「財務資料 - 綜合損益及其他全面收益表節選部份描述 - 毛利及毛利率」。

業 務

我們的定製及產品開發模式

定製化而非標準化

功率半導體領域，標準化的產品雖然能夠迅速滿足一般需求(例如低成本、短週期)，但在滿足客戶在差異化應用場合的特定需求方面卻有其限制。由於應用場景的多樣性，標準化的MOSFET及其他功率器件產品無法在所有參數上達到最佳平衡。多樣化的應用需要優化性能參數(如頻率、電壓和溫度)。標準化設計可能無法滿足該等需求，需要透過結構定製化和情境適應來克服瓶頸。因此，定製的MOSFET及其他功率器件產品可為客戶提供性能最佳化，精確符合各種場景的特定需求(例如：高頻率、高電壓、高溫穩定性)。此外，其亦能消除冗餘設計，提高關鍵參數(如效率、可靠性、尺寸)的競爭力，從而在性能、成本和可靠性方面實現最佳解決方案，降低系統成本。在其他情況下，我們或需改進或糾正客戶在其產品中已部署的現有設計組的缺陷。這通常涉及了解和解釋現有設計組、識別其技術問題及確定滿足客戶需求的有效定製方法。鑒於我們的業務方法側重於為客戶提供量身定製的解決方案，我們可能會混合及匹配市場上現有的功率器件產品、封裝方法、組件及材料，並酌情調整其一個或多個參數，為客戶開發新的定製產品，而非僅僅依靠我們的發明進行定製工作。因此，我們的技術能力不僅限於我們的知識產權，亦在很大程度上得益於我們對以下方面的廣泛了解：(i)功率器件組件的類型、封裝方法及材料，(ii)產品或組件參數及各自的輸出值，及(iii)最適合特定下游產品和客戶應用場景的項目與參數值的組合。我們與客戶進行合作及頻繁溝通，以充分了解其下游產品的規格及特性，為我們的定製工作奠定基礎。該定製過程是我們為客戶提供增值服務的重要組成部分。

為向客戶提供優質設計，我們將考慮若干關鍵指標以確定適當的設計庫(如適用)及定製選擇，即性能產量、可用半導體芯片面積、可用功率預算、使用過程中性能及功能退化的脆弱性以及使用過程中相鄰電路之間的不良干擾程度等。其他考慮因素包括交付時間表、成本控制或成本降低考慮因素、批量生產供客戶使用之必要設計的可行性及最終產品的預期用途和認證要求等。

我們產品的應用場景及工作流程圖

通常，我們提供定製產品，透過解決原始設計的瑕疵或開發新產品來滿足客戶的規格要求。若干情況下，我們客戶的下游產品成功通過了歐盟的相關進口要求，從而可在歐洲經濟區自由銷售。

業 務

場景1：解決原始設計缺陷

我們受到一家知名的家用電器製造商的委託，設計解決方案並製造低壓溝槽MOSFET，以解決客戶產品(智能家庭清潔機器人)中先前存在的技術問題。以下是此項目的詳情：

- **客戶要求及待解決問題：**客戶的智能掃地機器人遇到技術困難，包括運行時過熱導致功率效率下降，以及影響產品性能的電磁干擾。客戶希望我們解決產品過熱及電磁干擾等問題。
- **定製及開發流程：**我們與終端客戶合作，以了解及識別產品中的關鍵技術問題。然後，我們確定定製計劃、適當的晶圓基板和封裝結構等，再根據適當專業知識和能力，篩選晶圓代工廠及封裝廠。我們在整個製造過程中進行監督，以確保所製造的MOSFET符合客戶的規格。
- **我們的產品特性：**為解決客戶的技術問題，我們對MOSFET進行如下定製：(i)將最大電壓容限提高，為承受客戶產品啟動及關閉時產生的最大電壓尖峰提供安全緩衝；(ii)通過降低電氣元件之間不必要的電流傳導風險來減少電力干擾；(iii)減少能量損耗及發熱，並通過提高MOSFET開關速度以提高性能；(iv)通過將MOSFET的導通電阻降低，進一步減少其發熱量及降低傳導損耗；及(v)減小芯片尺寸等。
- **結果：**客戶產品內的過度加熱和電磁干擾問題得到解決，客戶產品的效率、運行時間和性能得到改善，產品的壽命也得到延長。此外，由於我們的MOSFET比客戶產品中的原始器件更緊湊、更節能，因此為客戶的產品提供了更好的性價比。客戶的產品之後符合歐盟的嚴格標準。

業 務

場景2：為新客戶產品開發新型MOSFET

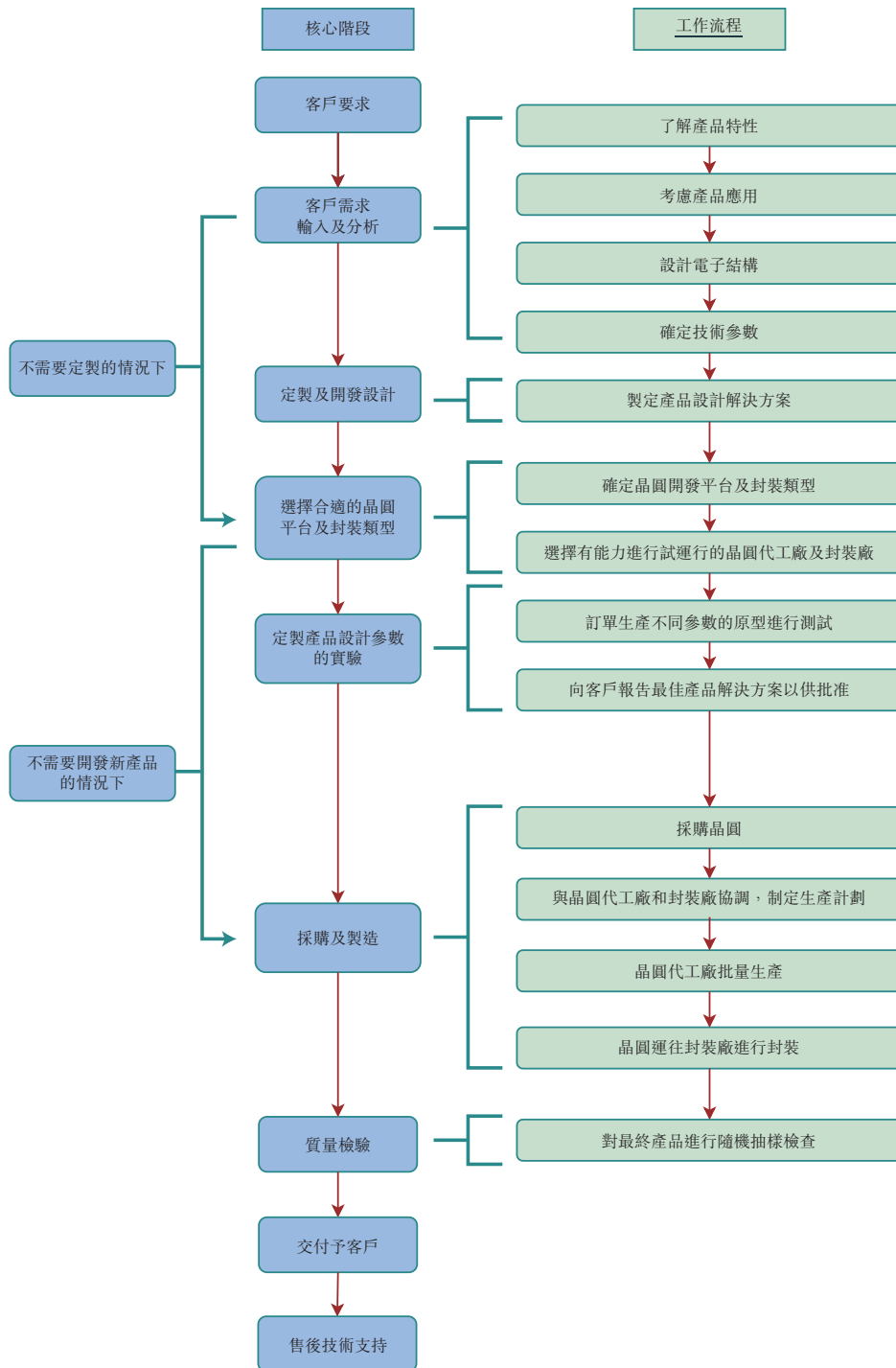
我們受中國的一家上市公司委託，開發用於客戶新產品(手持式鑽孔電動工具)的低電壓溝槽MOSFET。下表載列該項目的詳情：

- **客戶要求及待解決問題：**我們的客戶要求的新型MOSFET器件有望使彼等的電鑽能夠承受大瞬間電流並在該情況下運作，以適合嚴苛環境的使用。
- **定製及開發流程：**我們的銷售及營銷部門以及研發部門與客戶合作，了解客戶新型手持式鑽孔電動工具的電氣特性和內部系統設計。之後，我們決定了最佳的定製方案、合適的晶圓製造流程和封裝結構等，並根據適當的專業知識和能力，着手選擇晶圓代工廠和封裝廠。在整個製造過程中，我們提供明確的技術指引，並與工廠保持溝通，以確保低電壓溝槽MOSFET的新平台符合我們的規格。
- **我們的產品特性：**為滿足客戶的特定需求，我們確定了若干關鍵的電氣特性，以實現手持式電鑽工具的高電流處理能力和快速切換速度，同時優化其功率效率和性能，該等特性包括：(i)具有快速開關速度及低內阻的MOSFET，以最大限度地減少開關產生的能量損失及熱量；(ii)能夠支持大電流以滿足電動工具的高操作需求；及(iii)通過減少電器部件之間不必要的電流傳導的風險來減少電磁干擾。
- **結果：**我們為客戶定製的該低電壓溝槽MOSFET新平台與客戶之前使用的MOSFET相比，導通電阻大幅降低，開關速度提高。我們的設計還提高了能源效率，降低了發熱量和EMI(「電磁干擾」)。客戶的產品之後通過了歐盟的CE標誌，可在歐洲市場銷售。

業 務

產品開發流程

下列流程圖展示我們的業務營運模式：



業 務

以下是我們業務營運的工作流程：

1. 從新開發業務或現有客戶關係收到的客戶請求—我們的客戶或是通過我們的銷售及營銷部門的業務開發工作新獲取，或是我們先前向其提供產品解決方案的回頭客。工作流程以一種或兩種方式開始：

- *由本公司發起*：我們繼續使用我們向客戶推銷的產品解決方案；或
- *由客戶發起*：我們的客戶就產品提出的特定要求。

於該初始階段，我們與客戶進行討論並於需要時實地訪問客戶的場所了解其根本需求及具體要求，並通常會在降低成本、提高效率、優化現有技術或產品以及開發新產品解決方案的基礎上根據其需求定製產品解決方案。由於我們的大多數客戶請求需要定製，溝通對於確定所需的關鍵特性及功能至關重要，確保我們對整個流程有一個清晰的基礎。

2. 客戶需求輸入及分析—我們考慮客戶的需求及其產品的系統底層，以確保在我們的產品設計中充分反映客戶的需求。在此階段，我們確定客戶下游產品的屬性，並為產品定義或設計內部系統拓撲。基於客戶下游產品的實際應用，我們考慮我們的產品設計可能必須面對的各種場景，以確定產品所需的最佳參數範圍，包括電流流動的大小及速度、工作溫度限制、產品組件承受的電流及電壓以及其他條件。

我們亦將釐定在此階段是否需要定製以滿足客戶的需求，這將影響產品的開發工作流程。通常，開發合適的產品需要定製；然而，部分情況下，我們或會評估客戶的需求是否可以通過將該等需求與以下任一項相匹配來滿足：

- *與我們現有的產品解決方案相匹配*：我們先前開發的現成產品或解決方案；或
- *與市場既有產品解決方案相匹配*：市場上可用的標準化產品或解決方案。

對於該等情況，我們或會於必要時進行可行性研究，以釐定此類現成產品及解決方案是否最符合我們客戶的需求。倘毋須進一步定製，我們或會直接聘請選定的第三方代工廠及封裝廠量產最終產品。此階段作為我們定製產品設計的基礎。

業 務

3. **產品設計的定製及開發(倘根據客戶需求需要定製或開發新產品)**—與客戶進行詳細討論以確保徹底了解其需求、產品特性及系統底層的所有方面後，我們根據產品實際應用的可行性研究制定產品設計解決方案。通常，視乎我們客戶的具體需求及要求，產品設計解決方案可能涉及以下路徑：

- **優化現有產品解決方案**：對我們先前通過研發計劃開發或在業務過程中從市場獲得的現有產品解決方案進行調整或添加；或
- **開發新產品解決方案**：主要通過我們對行業趨勢的洞察，以自身的方式開發新產品。

為確定往後適當的工作路徑，我們將進行相關研發並進行可行性研究，以確保建議的解決方案最符合客戶的要求。我們的可行性研究根據外部因素(包括市場規模及產品的未來前景)以及我們目前在建議技術方面的市場競爭力考慮我們建議產品設計的技術及經濟可行性。除外部市場考慮因素外，我們的可行性研究一般包括對最終產品的成本、效率、生產率及保護控制要求免受過熱、短路、相鄰電路之間的干擾及其他對產品性能產生不利影響的情況等的考慮。然後成立一個跨部門團隊(「**跨部門團隊**」)，由來自不同部門(如研發、銷售及營銷以及運營)的代表組成，以制定具有明確的目標和目的的設計及開發計劃，根據所進行的可行性研究進行產品開發或優化。這可能涉及探索新技術或材料以增強產品的性能及可靠性，以及探索適合產品的封裝解決方案。有關我們設計活動的詳情，請參閱本節「**研發 — 我們的設計活動**」。

此外，倘我們需要開發新產品，我們會要求我們精心挑選並具備相關專業經驗及能力的晶圓製造代工廠及封裝廠根據我們的構思設計及規格開發的原型。創建各種參數集的原型進行測試。我們將繼續測試該等原型，以確定用於最終產品的最佳參數組合。

一般而言，無論項目是否需要開發原型，我們均會要求所選供應商開發少量的成品樣品，以自行進行驗證測試。之後，我們會將驗證過的樣品與客戶下游產品的樣品進行現場測試，以確保我們的產品與客戶的產品相容，並能在各種應用和功能場景下按照預期的方式運作。一旦測試結果令人滿意，我們會向客戶報告，以取得彼等的同意，並決定是否進行量產。有關我們選擇和委聘晶圓製造代工廠和封裝廠的詳情，請參閱本節「**採購**」。

業 務

一般而言，倘項目主要涉及為客戶定製封裝解決方案，此階段可能需要五至十週方能完成。倘項目進一步涉及定製或開發新的晶圓設計和電路樣式，則可能額外需要9個月至約13個月的時間。額外的開發時間需要用於設計晶圓樣式和開發原型，以及進行實驗和測試原型以確定其可靠性。因此，此階段實際所需的時間在很大程度上取決於項目的複雜性、工廠的產能以及是否需要開發原型進行測試。

4. **甄選合適的晶圓代工廠及封裝廠**—根據設計及開發計劃，我們將確定製造晶圓所需的合適設備及環境以及我們產品解決方案特定的封裝類型。憑藉我們廣泛的知識及供應商網絡，我們會精心挑選具備相關專業知識及能力的晶圓製造代工廠及封裝廠，以製造少量我們概念化產品的原型作實驗之用。甄選過程中，我們主要考慮以下因素：
 - *晶圓代工廠的甄選標準*：擁有基於我們特定產品設計方案製造(其中包括)所需厚度及材料的晶圓的專業知識及能力，包括合適的晶圓光刻、化學機械拋光、切割等設備及生產環境。
 - *封裝廠的甄選標準*：擁有基於我們特定產品設計方案將各種半導體組件集成按(其中包括)所需配置、材料、內容終端及電氣連接以及熱管理屬性進行封裝的專業知識及能力。
5. **採購製造所需的晶圓**—完成甄選程序後，我們可能會下訂單採購晶圓，以用於由我們所選的晶圓代工廠和封裝廠製造符合規格的定製產品。
6. **與供應商協定制訂及執行生產時間表**—客戶確認進行推薦產品解決方案的量產後，我們將制訂採購和生產時間表，並與供應商協調在材料、工作流程、產能、資金、管理和監督架構、人力和資源分配以及生產時間表等方面的安排，以確保滿足客戶所需的產品品質、數量和交貨時限。
 - *晶圓代工廠生產*：晶圓由選定的晶圓代工廠根據我們的規格進行生產並接受測試。通過測試的晶圓運送至我們的倉庫，或直接運送至封裝廠進行進一步加工。

業 務

- **封裝廠生產**：從所選晶圓代工廠收到的晶圓樣式會根據我們的規格封裝成最終產品，並接受測試。通過測試的封裝產品會運送到我們的倉庫作進一步檢查。
7. **品質檢驗**—為確保產品適合下一階段的開發，我們通常會進行以下品質檢驗：
- **晶片探針測試**：製造過程中，代工廠將測試晶圓的電氣和功能性能。在此階段製造的晶圓將使用自動測試設備(ATE)和晶圓探針進行測試，以篩選出不合格的晶圓。該等測試確保經訂約雙方同意後，僅符合產品數據表所列質量標準的晶圓將會進入封裝階段或運送至我們的倉庫。
 - **最終測試**：我們對封裝產品進行全面的功能和性能測試，以驗證其在實際應用中的可靠性和功效。不合格品將被篩選出來。一般而言，封裝廠會進行測試以確保製成品及封裝工藝所用材料符合歐盟環保標準RoHS及REACH指令。我們會提供適當的測試標準，以確保僅有品質合格的封裝產品才能進入交貨階段。詳情請參閱本節「—環境、社會及企業管治—環境影響管理」。
 - **倉庫檢驗**：通過最後測試的產品將發送至我們的倉庫進行進一步檢驗。我們採用可接受品質限值(AQL)來抽驗產品，包括執行外觀檢驗、內部檢驗和功能測試。若有任何樣品未能符合我們的品質標準，我們將根據AQL擴大樣品數量，以獲得適當的產品品質保證。倘經擴大樣本檢查後並無再發現不合格的情況，產品將被視為可發送至我們的客戶；否則，產品會退回，以修復缺陷並重新包裝為我們的產品，以便重新發貨。
8. **將產品發送至客戶**—通過我們的檢驗後，我們再將產品發送至客戶的倉庫。
9. **售後技術支持服務**—產品交付後，我們的技術產品部門將繼續為客戶提供與產品相關的技術支持。有關支持包括為解決客戶疑問提供諮詢和顧問服務、對有缺陷的產品進行交付後驗證、與客戶就退貨或已售商品進行協調，我們的技術人員提供現場支持服務。有關我們產品保修及退貨政策的詳情，請參閱本節「我們的產品—保修及退貨政策」。

業 務

該結構化的工作流程，結合我們與知名製造商的合作，確保我們的產品受益於先進的製造技術及嚴格的質量控制流程。此舉不僅提高了我們產品的性能及可靠性，亦使我們能夠快速高效地擴大生產規模。

我們專注於為客戶定製設計，使我們能夠在加強與客戶關係的同時實現高毛利率。通過定製產品以滿足各種應用的特定要求，我們不僅提高了產品的性能及效率，亦為客戶創造了更加個性化的體驗。投入定製培養忠誠度並鼓勵長期合作夥伴關係，使我們能夠更好地了解客戶需求並推動符合其業務目標的創新。

我們的產品供應

我們設計和銷售的產品，主要為MOSFET。作為現代電子產品中的關鍵組件，我們的MOSFET在廣泛的應用中實現高效的電源管理及信號放大。我們對創新及質量的投入確保我們的產品能夠滿足包括消費電子、工業控制、汽車電子、新能源及儲能以及醫療設備在內的各個行業的嚴格要求。

下表載列往績記錄期間各年度／期間我們產品的收益：

產品類型	產品類別	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
		2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
		人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	溝槽	61,316	36.6	46,902	41.5	53,228	43.8	37,244	45.7	39,787	37.8
MOSFET	SGT	100,895	60.3	59,686	52.8	59,565	48.9	39,168	48.1	57,873	55.0
	超結	4,987	3.0	6,374	5.6	8,625	7.1	4,994	6.1	7,290	6.9
	IGBT	-	-	10	0.0*	149	0.1*	24	0.03*	162	0.2*
	其他 ⁽¹⁾	111	0.1	79	0.1	89	0.1	36	0.04**	53	0.1**
	總計	167,309	100.0	113,051	100.0	121,656	100.0	81,466	100.0	105,165	100.0

附註1： 其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管。

附註*： 於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們銷售IGBT產品的收益分別約佔零、0.009%、0.122%、0.030%及0.154%。

附註**： 截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們銷售其他的收益分別約佔0.044%及0.051%。

業 務

有關我們於往績記錄期間收益重大波動的詳細分析，請參閱「財務資料－綜合損益及其他全面收益表節選部份描述－收益－按產品類型劃分的收益」。

我們於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月分別銷售約270.5百萬件、203.2百萬件、251.3百萬件、168.4百萬件及279.4百萬件產品，詳情載列如下：

產品類型 產品種類 小類		截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
		2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
		千件	%	千件	%	千件	%	千件	%	千件	%
MOSFET	溝槽	98,914	36.6	87,604	43.1	117,106	46.6	80,613	47.9	110,608	39.6
	SGT	168,790	62.4	111,321	54.8	128,798	51.3	84,369	50.0	162,698	58.2
	超結	1,945	0.7	3,736	1.8	4,990	2.0	3,168	1.9	5,507	2.0
IGBT		-	-	1	0.0*	103	0.0*	2	0.0*	53	0.0*
其他 ¹		877	0.3	539	0.3	333	0.1	279	0.2	531	0.2
總計		<u>270,526</u>	<u>100</u>	<u>203,201</u>	<u>100</u>	<u>251,330</u>	<u>100</u>	<u>168,431</u>	<u>100.0</u>	<u>279,397</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管。

*. 於2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們銷售IGBT的數量分別約佔總數量的0.001%、0.04%、0.001%及0.019%。

於2023財年，產品銷售總量約為203.2百萬件，較2022財年的約270.5百萬件減少約67.3百萬件或24.9%，主要是由於(i)SGT MOSFET的銷售減少約57.5百萬件；及(ii)溝槽MOSFET的銷售減少約11.3百萬件所致，這主要是由於中國功率半導體行業於2023年的去庫存週期，因疫情導致全球晶片短缺及對半導體器件的需求增加，導致需求由2022年大幅轉移至2023年。然而，產能增加及疫情後經濟復甦緩慢導致供需失衡，令2023財年對功率半導體的需求下降，部分被超結MOSFET銷售量增加約1.8百萬件所抵銷，該增加主要是由於一名客戶向我們採購的產品組合由溝槽MOSFET改為超結MOSFET。

於2023財年，我們錄得IGBT產品銷售約1,000件。

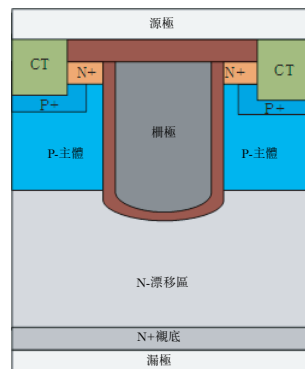
業 務

於2024財年，產品銷售總量約為251.3百萬件，較2023財年的約203.2百萬件增加約48.1百萬件或23.7%。該增長主要是由於我們客戶的業務活動普遍增加所致，這可從我們於不同應用場合(如工業控制、消費電子、新能源及儲能以及醫療設備)的產品採購量增加可見一斑。於2024財年，我們的IGBT產品銷售亦錄得增長至約0.1百萬件，主要是由於售予一名中國新客戶約0.1百萬件所致。

截至2024年9月30日止九個月與截至2025年9月30日止九個月比較，銷售總量由約168.4百萬件增加至約279.4百萬件。於2025年首九個月，我們延續2024財年的策略，利用現有客戶增加的業務活動增加，並繼續努力增加我們的客戶基礎。

MOSFET是一種場效應晶體管，其在控制電力方面發揮著關鍵作用。其通過使用電壓控制電流的流動，使其成為開關及放大電子信號的理想選擇。MOSFET以其高效、快速開關能力及低功耗而著稱，於當今的電子器件中不可或缺。其能夠在保持低導通電阻的同時處理高壓及電流，為電力應用中節能及提升性能貢獻突出。MOSFET可進一步細分為不同類型。

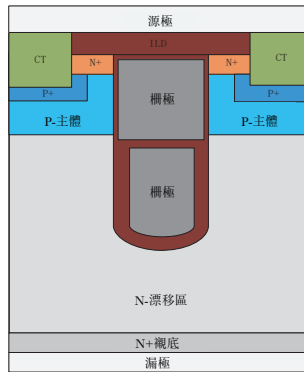
1. **溝槽MOSFET**。溝槽MOSFET採用溝槽結構設計，能夠更好地利用表面積，從而降低導通電阻、增強熱穩定性並提高效率。該設計是介於約12伏至250伏之間中低電壓電力應用的理想選擇。溝槽MOSFET特別適用於各種應用中的電源管理，包括控制開關、DC-DC轉換器、汽車電子等。



溝槽MOSFET的設計佈局

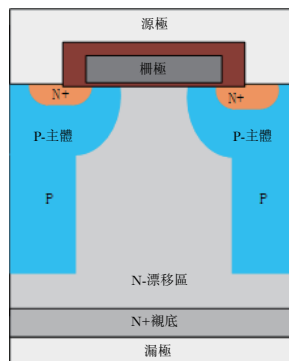
業 務

2. **屏蔽柵溝槽(SGT) MOSFET**。SGT MOSFET是一種在傳統MOSFET的基礎上增加了多晶硅電場板的晶體管，用於電場調變，使其能夠承受更高的電壓並降低元件的導通電阻。因此，SGT擁有非常低的導通電阻，在電流切換時的功率損耗也很低，因此能夠實現優異的切換性能。該設計非常適合30伏至300伏的中低功率應用。SGT特別適用於開關電源供應器、馬達控制和電源管理系統，可應用於快速充電器、電動車和無刷馬達。



SGT MOSFET的設計佈局

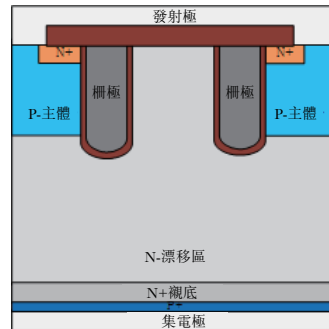
3. **超結MOSFET**。超結MOSFET是最新一代的MOSFET，結合了低導通電阻與高電壓能力。該設計非常適合高達900伏的高壓功率應用，因此特別適合高壓應用，包括電動汽車和可再生能源系統。超結MOSFET的應用包括太陽能逆變器、工業電源供應器、車載充電器。



超結MOSFET的設計佈局

業 務

IGBT是一種結合MOSFET及雙極晶體管優點的晶體管，提供高電壓和電流處理。其特別適用於高壓及大電流應用，是電動汽車、可再生能源系統、醫療設備及工業電機驅動器的理想選擇。IGBT提供出色的性能，為穩定供電的關鍵。



IGBT的設計佈局

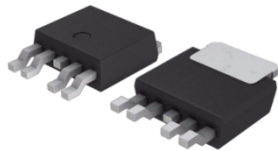
圖例

- CT 集電終端：晶體管上電流可進出的連接點。
- N + N型摻雜區：半導體中大量注入額外電子的區域，有助於高效導電。
- P + p型摻雜區：充滿「空穴」(電子可存在的地方)的區域，使其也能導電，但導電方式與N+區不同。
- P-主體 p型主井區：構成器件基底的半導體部分，通常由p型材料製成。
- N-漂移區 n型漂移區：允許電子在半導體中移動而並無太大阻力的區域，有助於更有效地傳輸電力。
- N+襯底 N類襯底：摻雜大量電子的半導體基礎層，為其他組件提供堅實基礎

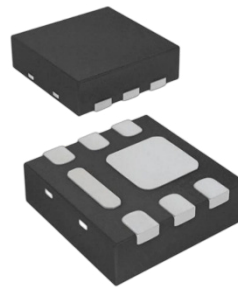
產品類別	產品類型 小類	開發里程碑		參數				
		開始開發	產品推出日期	電壓範圍 伏特(V)	頻率範圍 赫茲(Hz)	短路容量 微秒(μs)	最大運行溫度 $^{\circ}C$	電流大小範圍 安(A)
MOSEFT	溝槽	2011年12月	2012年3月	12~250	30K~100K	無	(55)-150	0.11~211
	SGT	2012年3月	2012年6月	30~200	30K~200K	無	(55)-150	2.5~550
	超結(SJ)	2019年12月	2020年6月	300~1200	30K~200K	無	(55)-175	2~100
IGBT		2018年6月	2018年12月	650~3300	5K~60K	>10	(55)-175	5~75
GaN MOSFET		2021年12月	2022年3月	650	30K~300K	無	(55)-175	4~15
SiC MOSFET		2021年12月	2022年3月	650~1700	30K~300K	<2	(55)-175	6.4~125

業 務

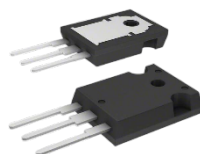
下圖說明我們的產品(以各種封裝形式)：



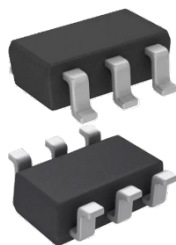
晶體管外形252-4



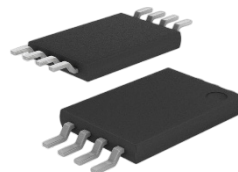
雙面平整無鉛2mmX2mm



晶體管外形247



薄小外形封裝-6



超薄外形封裝-8

業 務

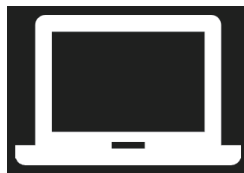
本公司產品的下游應用

我們的產品已應用於多種電子設備及下游產品。下表載列於往績記錄期間，我們產品按其應用於客戶下游產品的銷售所產生的收益明細：

下游產品應用	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	估收益的		估收益的		估收益的		估收益的		估收益的	
	收益	百分比	收益	百分比	收益	百分比	收益	百分比	收益	百分比
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
消費電子	111,759	66.8	71,119	62.9	68,241	56.1	45,605	56.0	59,129	56.2
工業控制	35,205	21.0	33,976	30.0	40,916	33.6	27,705	34.0	31,790	30.2
汽車電子	16,862	10.1	2,999	2.7	3,873	3.2	2,240	2.7	6,797	6.5
新能源及儲能	3,447	2.1	4,955	4.4	8,619	7.1	5,908	7.3	7,449	7.1
醫療設備	36	0.0*	2	0.0*	7	0.0*	8	0.0*	-	0.0*
總計	<u>167,309</u>	<u>100</u>	<u>113,051</u>	<u>100</u>	<u>121,656</u>	<u>100</u>	<u>81,466</u>	<u>100.0</u>	<u>105,165</u>	<u>100.0</u>

(未經審核)

附註*：於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，用於醫療設備的產品分別約佔0.021%、0.001%、0.006%、0.01%及零。



消費電子



工業控制



新能源及儲能



汽車電子



醫療設備

於往績記錄期間，我們產品主要用於多個下游產品分部，即消費電子、工業控制、新能源及儲能以及醫療設備產品，我們於開發過程中累積了技術知識和實踐經驗。

- **消費電子**。該下游產品分部包括掃地機器人、手持電動工具、吸塵器、各種消費電子適配器、智能手機設備、LED照明、電子煙、快速充電器等。我們通常用於該分部的產品主要是SGT MOSFET、溝槽MOSFET及超結MOSFET，其工作壽命通常為5年。

業 務

- **工業控制**。該下游產品分部主要包括大型開關及控制面板、伺服電機、工業伺服器、機械臂等。我們通常用於該分部的產品主要是SGT MOSFET、溝槽MOSFET、超結MOSFET及IGBT，其工作壽命通常為5年。
- **汽車電子**。該下游產品分部主要包括汽車照明、娛樂及電力系統等。我們通常用於該分部的產品主要是SGT MOSFET及溝槽MOSFET，其工作壽命通常為5年。
- **新能源及儲能**。該下游產品分部主要包括太陽能保護板、太陽能充電裝置、光電戶外儲能裝置等。於往績記錄期間，我們通常用於該分部的產品主要是SGT MOSFET、溝槽MOSFET及超結MOSFET，其工作壽命通常為5年。
- **醫療設備**。該下游產品分部主要為醫療設備，包括醫用霧化器電源元件、醫療設備傳輸及電源元件、自動體外除顫器電流動能元件等。我們通常用於該分部的產品主要是溝槽MOSFET及SGT MOSFET，其工作壽命通常為5年。

產品的定價

我們主要根據一系列因素決定產品價格，包括(i)我們產品的生產成本，其中包括原材料採購成本、外包給第三方代工廠和封裝廠的生產成本、規劃和管理產品設計、開發、製造和測試階段的成本、研發開支和營運成本；(ii)我們客戶所要求的產品類型和複雜程度以及客製化程度；(iii)可比產品的競爭格局，其中考慮到我們相對於競爭對手的優勢和劣勢、彼等的定價策略以及消費者對產品的成本敏感度。由於我們的產品生產外包給第三方晶圓代工廠及封裝廠，基於規模經濟的原則，其每件產品的平均生產成本會因大量訂單而降低，因此客戶若一次訂購較多件，一般會以較低的每件價格支付。

業 務

於往績記錄期間，我們產品的平均售價載列如下：

產品類型		截至12月31日止年度			截至2025年 9月30日 止九個月
產品類別	小類	2022年 人民幣元	2023年 人民幣元	2024年 人民幣元	人民幣元
MOSFET	溝槽	0.62	0.54	0.45	0.36
	SGT	0.60	0.54	0.46	0.36
	超結	2.56	1.71	1.73	1.32
IGBT		–	9.17	1.45	3.04
其他 ⁽¹⁾		0.13	0.15	0.27	0.10

附註1：其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管。

於往績記錄期間，溝槽MOSFET及SGT MOSFET的平均售價呈下降趨勢。溝槽MOSFET的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.62元降至截至2025年9月30日止九個月的每件約人民幣0.36元，而SGT MOSFET的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.60元降至截至2025年9月30日止九個月的每件約人民幣0.36元。於2023財年，該跌幅主要由於2022年底產能增加及市場需求減弱導致原材料價格普遍下跌，從而導致存貨過剩。於2024財年，溝槽MOSFET及SGT MOSFET的平均售價繼續下降，主要是由於原材料價格進一步下調所致。截至2025年9月30日止九個月，平均售價下調是透過客戶協商策略性實施，以提升市場競爭力。

就超結MOSFET而言，平均售價由2022財年的每件約人民幣2.56元降至2023財年的每件約人民幣1.71元，主要是由於原材料價格下降所致，原因如上文所述。於2024財年，平均銷售價略升至每件約人民幣1.73元，主要是由於年內向一名主要客戶銷售的型號組合發生變化，包括向該客戶售出某一平均售價較高的型號240,000件(而2023財年並無此項銷售)。截至2025年9月30日止九個月，平均售價降至每件約人民幣1.32元，反映策略性降價以提升市場競爭力，與上述方法一致。

就IGBT產品而言，平均售價由2023財年的每件約人民幣9.17元降至2024財年的每件約人民幣1.45元，主要是由於年內向新客戶銷售100,000件某一型號的IGBT產品所致，該型號的平均售價較2023財年售出的IGBT型號為低。截至2025年9月30日止九個月，平均售價上升至每件約人民幣3.04元，主要是由於銷售價格較高的IGBT型號所致，其為截至2025年9月30日止九個月銷售的主要型號，性能相比2024財年銷售的主要型號有所提升。

業 務

其他產品的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.13元微增至2023財年的每件約人民幣0.15元，主要是由於2023財年銷售228件SiC MOSFET及6件GaN MOSFET，兩者的平均售價均高於2022財年售出的該類別其他產品的平均售價。於2024財年，此類產品的平均售價進一步上升至每件約人民幣0.27元，主要是由於銷售2023財年未售出的平均售價較高的晶圓所致。截至2025年9月30日止九個月，平均售價降至每件約人民幣0.10元，反映策略性降價以提升市場競爭力，與應用於其他產品類別的方法一致。

產品供應的地理區域

我們的產品主要在中國市場營銷，中國目前及將來均是我們業務的核心重點。目前，不足5%的產品銷往海外，主要為(i)東南亞、南亞及其他地區。下表載列於往績記錄期間我們按地理區域劃分的銷售收益總額：

地理區域	截至12月31日止年度					截至9月30日止九個月				
	2022年	2023年		2024年		2024年	2025年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國	162,140	96.9	110,168	97.4	116,706	96.0	77,816	95.5	102,598	97.6
東南亞、南亞及 其他地區(附註1)	5,169	3.1	2,883	2.6	4,950	4.0	3,650	4.5	2,567	2.4
總計	167,309	100	113,051	100	121,656	100	81,466	100.0	105,165	100.0

附註1：東南亞、南亞及其他地區主要包括馬來西亞、韓國及歐洲國家。

於各往績記錄期間，我們於中國的銷售額佔總收益的95%以上。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，來自中國的收益分別約為人民幣162.1百萬元、人民幣110.2百萬元、人民幣116.7百萬元、人民幣77.8百萬元及人民幣102.6百萬元。

於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，向東南亞、南亞及其他地區的銷售額分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣2.9百萬元、人民幣5.0百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣2.6百萬元。

有關波動的詳細原因，請參閱本文件「財務資料－各期經營業績的比較」。

儘管我們的核心重點仍在中國市場，但我們計劃擴大在馬來西亞和越南的市場及銷量，並在其他東南亞及南亞市場(即新加坡和印度)建立我們的市場地位。詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」一節。

業 務

我們的項目

新項目指於特定年度內，首次與特定客戶展開合作，為其開發或匹配某款特定產品型號以滿足其特殊需求；而既有項目則指過往與特定客戶就某款特定產品型號展開的合作，該項目透過同一客戶後續提交的相同產品型號採購訂單，持續為本集團創造收益。

項目變動

於2022財年、2023財年及2024財年，我們共參與1,911個、1,874個及1,991個新項目及既有項目，以及截至2024年9月30日及2025年9月30日止九個月，我們共參與1,660個及1,901個新項目及既有項目。各項目應佔收益均源自同一客戶於年內就相應產品型號所下採購訂單的總價值。

下表顯示往績記錄期間新項目及經常性項目的數量以及該等項目各自的收益詳情：

	截至12月31日止年度						截至9月30日止期間			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	項目數量	收益	項目數量	收益	項目數量	收益	項目數量	收益	項目數量	收益
	人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元	
新項目	1,237	21,804	1,060	33,136	1,050	33,000	753	15,713	784	15,059
既有項目	674	145,504	814	79,915	941	88,656	907	65,752	1,117	90,106
總計	<u>1,911</u>	<u>167,308</u>	<u>1,874</u>	<u>113,051</u>	<u>1,991</u>	<u>121,656</u>	<u>1,660</u>	<u>81,465</u>	<u>1,901</u>	<u>105,165</u>

於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們與客戶分別開展1,237個、1,060個、1,050個及784個新項目，而同期持續為我們帶來收益的既有項目為674個、814個、941個及1,117個。

2022年至2023年及2023年至2024年我們承接的新項目數量減少與研發費用減少一致，主要是由於該期間定製及設計工作減少所致。相反，於2022財年及2023財年，儘管新項目數量減少，但同期有關新項目產生的收益由約人民幣21.8百萬元增至約人民幣33.1百萬元，主要是由於該等新客戶需求不斷增加，導致客戶購買我們產品的金額增加。該增加主要包括因現有客戶對我們產品品質的高度信賴，2023財年來自彼等進行的新項目所購買我們的產品。

業 務

儘管截至2024年9月30日及2025年9月30日止九個月，我們承接的新項目數量有所增加，但新項目應佔收益由約人民幣15.7百萬元減少至人民幣15.1百萬元，主要是由於(i)大量購買特定產品型號的個人客戶數量減少，導致有關採購額減少，及(ii)供客戶在試運行中使用以測試我們的產品型號的小訂單產品型號數量增加。

於往績記錄期間，持續為本集團帶來收益的既有項目數量增加，主要是由於我們的客戶於有關期間持續下達採購訂單，訂購我們於過往年度已完成項目中為其定製或匹配其特定需求的產品。相反，儘管同期新項目數量增加，但有關既有項目的收益卻由2022財年的約人民幣145.5百萬元減至2023財年的人民幣79.9百萬元，主要是由於：(i)(a)我們的一名主要客戶(客戶H)於2023財年因內部業務部門重組而停止向我們下單，而該客戶於2022財年貢獻約人民幣25.9百萬元，佔我們收益的15.5%；及(b)我們將與客戶H的銷售關係轉移至另一名客戶(客戶F)，而客戶F於2023財年向我們的下單量減少，主要是由於該客戶的需求減弱，符合半導體行業去庫存週期。詳情請參閱「財務資料 – 綜合損益及其他全面收益表節選部份描述 – 按下游應用劃分的收益 – 消費電子」；及(ii)在全球半導體供應短缺促使行業參與者囤積半導體產品的情況下，2022財年我們的客戶對每個項目相同產品型號的購買量增加，惟因供應過剩及市場需求疲軟，2023財年改為下達小額訂單。詳情請參閱本節「我們的項目 – 我們項目的訂單量」。

重點項目

於往績記錄期間，單個項目對本集團的收益貢獻通常不大。然而，我們的部分客戶於2022財年為我們的收益作出重大貢獻，這與疫情後全球芯片短缺及同期對半導體器件的需求增加相一致。2022財年，我們僅有一個項目貢獻超過10%的收益。於2023財年、2024財年及截至2025年9月30日止九個月，我們的項目概無貢獻10%或更多的收益。

業 務

於相關年度對我們收入貢獻至少10%的重點項目詳情如下：

截至2022年12月31日止年度

項目類型	項目描述	客戶	產品規格	本年度 項目收益 貢獻 人民幣千元	本年度 項目貢獻的 收益佔 總收益的 百分比 %
1. 既有項目	開發/定製SGT MOSFET型號，涉及改進技術，用於集成到個人服務器設備電路中	客戶H ¹	為客戶個人服務器產品的中高壓直流應用部分定製的SGT MOSFET，同時滿足其對低內阻、高電流及強輸出能力的技術需求	22,867	13.7

附註：

1. 客戶H為一家於中國註冊成立的私人有限公司，總部位於深圳，主要從事開發超級計算芯片、硬件及軟件產品。詳情請參閱本節「-客戶 - 五大客戶」。

業 務

我們項目的訂單量

於往績記錄期間，本集團不時從本集團客戶發出的採購訂單中產生收入。下表載列於往績記錄期間內及直至最後實際可行日期，本集團進行中及已完成之採購訂單數目及價值(稅後)之變動詳情：

截至2022年12月31日止年度	採購 訂單數量	採購 訂單總金額 人民幣千元	平均採購 訂單金額 人民幣元
結轉採購訂單	227	20,823	91,733
新採購訂單 ¹	3,993	189,766	47,525
已完成採購訂單 ²	3,801	167,309	44,017
年末結轉採購訂單(未完成訂單)	419	43,280	103,295
截至2023年12月31日止年度			
結轉採購訂單	419	43,280	103,295
新採購訂單	5,854	119,740	20,454
已完成採購訂單	5,548	113,051	20,377
年末結轉採購訂單(未完成訂單)	725	49,970	68,924
截至2024年12月31日止年度			
結轉採購訂單	725	49,970	68,924
新採購訂單	6,888	129,647	18,822
已完成採購訂單	6,650	121,656	18,294
年末結轉採購訂單(未完成訂單)	963	57,961	60,188
截至2025年9月30日止期間			
結轉採購訂單	963	57,961	60,188
新採購訂單	5,524	112,855	20,430
已完成採購訂單	5,583	105,165	18,837
年末結轉採購訂單(未完成訂單)	904	65,651	72,622

業 務

於往績記錄期內，由一個財政年度結轉至下一個財政年度的平均採購訂單金額明顯高於各年所收到的採購訂單金額，主要是由於(i) COVID-19疫情之後，2022年及之前客戶下單的大量採購訂單未完成的殘留影響，當時全球半導體供應短缺推動行業參與者囤積半導體產品；及(ii)我們業務的季節性質，其中2022財年、2023財年及2024財年第四季度的銷售額普遍佔我們年度收益的最大份額，分別約為人民幣52.4百萬元、人民幣29.6百萬元及人民幣40.3百萬元，分別佔31.1%、26.2%及33.1%，是由於當期前後客戶向我們下達的訂單量更大，而此可能會結轉至下一個財政年度。有關我們業務季節性的詳情，請參閱本節「-季節性」。

此外，往績記錄期間我們採購訂單的平均值下降，是由於2022年初至2023年市場需求疲軟及由此導致半導體進入去庫存週期，客戶與我們下單時採取更為審慎的方式。特別是，彼等從一次訂購大量產品轉為小量、多次訂單，以衡量下游產品的市場需求變化，而無需過度囤積存貨。其他影響訂單量及規模的因素包括：(i)現有客戶對相同產品的價格要求同比降低，及(ii)因應新的下游創新及產品推出使產品需求多元化，導致訂單更加分散。因此，雖然下達的採購訂單數量有所增加，但此類訂單的平均購買價值有所下降。

於2025年9月30日，積壓採購訂單數額涉及1,059份金額合計約人民幣65.7百萬元的訂單。

於2022財年、2023財年及2024財年，我們分別有22份、105份及145份虧損採購訂單，總虧損分別約人民幣27,800元、人民幣147,300元及人民幣99,200元，主要是由於各年若干客戶訂購或複訂的產品數量相對較少所致。因此，由於缺乏規模經濟，透過此類採購訂單銷售產生的收益無法覆蓋生產相關產品所產生的成本。2022財年虧損項目數目及總額相對較低，主要是由於2022年經濟復甦及市場對我們產品的需求強勁，而2023財年虧損項目數目及總額增加則是由於2023年半導體行業需求疲軟導致本集團業務萎縮所致，從而導致我們的客戶下達的數量及訂單數目減少。此外，鑑於2023年市場需求疲軟，我們願意接受小額虧損，以便與新客戶建立長期業務關係。該策略亦於2024財年繼續進行，以確保本集團與新客戶建立更多業務關係，從而導致虧損項目數量相對較多，但由於市場狀況改善，整體虧損減少。

業 務

季節性

根據我們的經驗，2023年第一及第二季度除外，該兩季因客戶於2022年全球供應短缺所引發的囤貨週期尾聲大量下達剩餘採購訂單，致使訂單數量相對較高。我們通常於每年第四季度錄得相對較高的收益，其與每年年底前後的慶祝活動導致客戶銷售額增加相吻合。根據益普索的資料，該季節性趨勢通常與行業慣例一致。下表記錄2022財年、2023財年及2024財年各季度的應佔收益：

	第一季度收益		第二季度收益		第三季度收益		第四季度收益		全年收益	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
2022年	31,271	18.7	43,627	26.1	40,172	24.0	52,239	31.2	167,309	100
2023年	27,454	24.3	32,083	28.4	27,134	24.0	26,380	23.3	113,051	100
2024年	25,389	20.9	25,141	20.7	30,787	25.3	40,339	33.1	121,656	100

保修及退貨政策

客戶收到我們的產品後，須在三天內以書面形式通知我們任何明顯的損壞或產品數量不匹配，之後雙方將立即合作了解問題的原因並採取措施解決問題。

我們向客戶提供產品規格手冊，以便彼等在我們的產品交付後自行檢查，並可直接聯繫我們的銷售及營銷部門下的客戶服務部，以獲得有關各種技術及應用事宜的建議與協助。如我們的產品不符合其預期規格，我們將在收到客戶報告後對我們的產品進行內部評估。如內部評估確認產品不匹配或有瑕疵，研發部門的質量控制團隊將通知銷售及營銷部門的客戶服務團隊發起退貨請求，以完成退換貨流程。這通常會涉及召回我們的產品，並聯繫我們的供應商，主要是負責我們產品的封裝廠，以彌補已發現的缺陷或交付批次中要求的產品數量的不足。

此外，在收到有關我們產品的任何異常操作或功能的書面報告後，我們將安排技術人員到客戶的場所進行現場訪問，以與客戶的人員合作提供現場協助及檢查。如雙方代表就問題的性質達成一致，雙方將作出進一步安排以解決或議決問題。如雙方代表無法就問題的性質達成一致，雙方將同意並共同聘請第三方專家進行分析並就問題給出最終意見，費用由雙方共同承擔。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司並無遇到任何對本公司業務造成重大不利影響的產品退貨。

業 務

設計及研發

我們認為，我們廣泛了解產品的技術規格及特性、功能及應用，並據此進行日常設計及研發活動。我們的設計及研發乃由不同部門之間的密切合作共同進行。我們的銷售及營銷部門熟悉行業，更貼近客戶，負責候選產品的初步構思，該構思通常源自內部創意及向客戶收集的資料。我們的研發部門由功率器件設計組、產品開發組及產品技術組組成，負責產品的設計及開發。除我們的研發部門成員外，我們銷售及營銷部門的若干成員亦擁有技術背景，我們相信其直接有助於不同部門之間的有效無縫協作，以成功順利進行產品設計。

多年來，我們通過研發努力，開發了知識產權組合，我們認為該等知識產權對我們的業務運營至關重要。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有15項發明專利、5項實用新型專利、47項集成電路佈圖設計專有權、15項軟件版權及4項商標。

我們的設計活動

設計活動分為五個階段，每個階段均旨在確保我們的產品具有最優質量和創新，以及產品對客戶需求的適用性。

首先，研發部門與銷售及營銷部門合作，收集並分析客戶需求及市場資料，擬定定製產品或新產品的研發提案。其後，該提案由銷售及營銷部門、研發部門的主管以及總經理審核與核准後方可開始。將成立由研發、銷售及營銷以及運營等不同部門代表組成的跨部門團隊（「**跨部門團隊**」），將產品需求細分為特定的設計與開發任務，包括釐定詳細的產品規格、封裝需求，以及進行風險評估以找出潛在的挑戰。此階段的成果包括全面的設計規格和參數文件，該等文件將指導後續階段的開發。

確定具體的產品規格和參數後，跨部門團隊會考慮量產所需的必要製造能力，以及糾錯機制方法，以盡量降低製造過程中的風險。該團隊亦會評估供應商的能力，以確保外部合作夥伴能夠滿足我們訂立的嚴格品質標準。之後，跨部門團隊會組織選定的供應商進行試產，試產期間生產最初批次的產品原型。我們會進行徹底的測試和評估，以確保產品原型適合用途，製造過程有效並符合既定標準。任何必要的調整均會於全面生產開始前確認和實施，以確保最終產品的最高品質和適用性。

業 務

最後階段是一個持續的過程，以確保我們的定製和研發工作能夠積極回應市場需求。銷售及營銷部門收集客戶的品質回饋進行分析，以找出需要改進的地方。研發部門會總結該等資料，以便進行部門審查。各部門負責迅速處理內部或外部持份者所報告的任何品質問題，並視需要實施糾正和預防措施。此階段體現了我們對持續改進的承諾，對設計和工序產出的定期審查確保了我們的研發實踐與不斷變化的市場條件和技術進步保持一致。

我們的研發部門

我們的研發部門由劉鵬飛先生領導，劉先生於集成電路及半導體行業擁有豐富的經驗。劉先生曾於多家公司擔任高級職位，包括於深圳比亞迪微電子有限公司及華為技術有限公司等世界知名的跨國機構擔任芯片開發及工程部門的主管或高級職位，以及隨後於國內知名半導體開發企業擔任研發職位，累積了豐富且多元的行業實踐經驗。劉先生擁有深厚且廣泛的行業知識和經驗，而且擁有武漢理工大學工商管理碩士學位，對客戶的業務需求有敏銳的理解。

在其領導下，研發部門培養出創新與卓越的文化，專注於開發定製產品以滿足客戶不斷變化的需求。我們的研發部門年輕有為、愛崗敬業且具創新力。於最後實際可行日期，我們的研發部門由13名成員組成，彼等擁有大學學歷，主要擁有電子信息工程領域專業知識。

研發開支

所有研發成本於產生時自損益扣除。

開發新產品的項目所產生的開支僅於本集團能夠證明完成無形資產以使其可供使用或銷售的技術可行性、其完成的意向及其使用或銷售該資產的能力、該資產將如何產生未來經濟利益、可獲得完成項目的資源以及能夠可靠地計量開發期間的開支時方予以資本化及遞延。不符合該等標準的產品開發開支於產生時支銷。進一步詳情請參閱本文件「附錄一一會計師報告」。

於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們的研發開支分別為人民幣9.5百萬元、人民幣7.3百萬元、人民幣5.8百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣6.7百萬元。

業 務

採購

我們採用無晶圓廠模式運營，以優化我們的產品設計能力。與公司執行產品的設計、製造、封裝及測試的IDM模式不同，採用無晶圓廠模式運營的公司專注於設計流程，並將製造工序外包予代工廠。無晶圓廠模式使我們能夠以有限且高效的資本投入將我們的設計資源及能力最大化。

於往績記錄期間，我們主要採購晶圓，其為我們產品的原材料。採購職能由我們的運營部門管理，供應商的技术要求主要由我們的研發部門及運營部門界定。該協作方法確保我們的採購戰略與產品所需的技術規格保持一致。

於往績記錄期間，我們於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月分別聘請49家、60家、73家及73家第三方供應商。同期，在該等供應商中，35家、43家、55家及51家為晶圓代工廠，14家、17家、18家及22家為封裝廠。為規範我們供應商的選擇流程，我們制定了政策和程序，規定了選擇的一般原則和標準，以及確定和評估參與項目的代工廠和封裝廠的程序。我們的運營管理部門通常透過行業會議、公共信息、業務推介、實地訪問確定我們的銷售及營銷部門所推介的潛在代工廠及封裝廠。我們對具備必要產能及技術資質並符合我們研發部門設定的基準的供應商進行初步審查。該初步評估對於過濾掉不符合我們標準的供應商至關重要。一旦確定潛在供應商，我們的運營管理團隊將安排我們的研發部門於代工廠及封裝廠的生產設施進行現場審核。該等審核專注評估供應商的實力是否可達到我們的技術標準，包括其生產流程、質量控制措施、產品責任管理及整體運營效率。僅成功滿足我們的技術標準及規格的代工廠和封裝廠方會被列入我們的核准供應商名單。考慮是否接納供應商或將其從清單中剔除時，我們的營運管理團隊亦會考慮供應商的特定能力、客戶組合、服務和產品品質、生產能力、交付時間、過往表現及定價等因素，尤其注重我們的整體合作經驗以及從過往項目中掌握其營運和能力的實際和第一手知識，以篩選出適合特定項目的供應商。為確保我們選擇供應商的流程保持最新和有效，我們定期審查內部選擇標準、政策和程序。

我們的生產規劃團隊根據訂單數量、預期交付時間及當前庫存水平等因素制定採購計劃。隨後，本公司營運部門的採購團隊將根據採購計劃向核准代工廠下達訂單。生產完成後，代工廠將晶圓運送至我們的倉庫或直接運送至指定的封裝廠。倘晶圓運送至我們的倉庫，我們的採購團隊將再安排，將晶圓運送至封裝廠進行最終封裝，然後將成品運回我們的倉庫。

業 務

我們的原料採購價

我們向供應商採購各種原材料，以保持對品質的控制並確保該等原材料適合我們的供應商製造終端產品的工序。我們採購的原材料通常包括晶圓。我們主要購買晶圓供第三方晶圓代工廠用作製造產品。我們進一步聘請第三方封裝廠，將晶圓封裝成我們的最終產品。於往績記錄期間，2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月的晶圓採購總額分別約為人民幣32.6百萬元、人民幣24.0百萬元、人民幣35.4百萬元及人民幣45.2百萬元，而同期的封裝服務採購總額分別約為人民幣13.8百萬元、人民幣11.5百萬元、人民幣15.9百萬元及人民幣17.4百萬元。本集團每件晶圓的採購價範圍(i)於2022財年介乎約人民幣1,890元至人民幣4,854元；(ii)於2023財年介乎約人民幣809元至人民幣4,524元；(iii)於2024財年介乎約人民幣692元至人民幣6,494元；及(iv)於截至2025年9月30日止九個月介乎約人民幣666元至人民幣9,900元。由於我們正在開發一款具有特定測試要求的新產品，因此截至2025年9月30日止九個月對某種晶圓進行小批量採購，導致晶圓採購成本高達每件約人民幣9,900元。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2025年9月30日止九個月各件晶圓的平均採購成本分別約為人民幣2,615.1元、人民幣2,329.0元、人民幣2,016.4元及人民幣1,922.6元。

採購晶圓的成本主要受到代工廠將硅、SiC或GaN晶圓製成具有特定功能和應用場景的晶圓時，以及市場對代工廠製造能力的需求所影響。一般而言，代工廠依據特定設計需求採用較複雜的製造工序會導致樣式晶圓的價格較高。舉例來說，對尺寸與整合度有更嚴格要求的晶圓的採購價也較高。因此，根據益普索的資料，8英寸MOSFET晶圓的採購價可能因產品設計規格、性能參數及目標應用場景的不同而有顯著差異。

為了有效管理與原材料及消耗品價格波動相關的風險，我們分析主要原材料的消耗量和其他數據，研究市場趨勢，並編製年度採購預算。我們努力優化庫存水平，從而提高成本管理和效率。我們所用的大部份原材料均可自多個供應商獲得，並能以具有競爭力的市價採購。因此，我們不依賴任何特定供應商提供任何特定項目。於往績記錄期間直至最後實際可行日期，我們的業務並未因原材料供應短缺或延遲而受到任何重大干擾。倘原材料價格上漲，我們應該能夠調整產品的售價，以反映原材料價格的上漲。

業 務

於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，按採購總額計，分別約100.0%、100.0%、94.0%及92.9%的原材料採購自中國境內的供應商。

我們的供應商

我們的五大供應商

下表載列於往績記錄期間各年度／期間我們的五大供應商的若干詳情：

我們的供應商主要包括從事晶圓銷售、晶圓及功率器件製造與封裝的公司。於往績記錄期間各年度／期間，我們向五大供應商的採購額分別約佔2022財年、2023財年、2024財年及截至2025年9月30日止九個月採購總額的73.8%、61.7%、55.0%及56.4%。同期，於往績記錄期間各年度／期間我們向單一最大供應商的採購額分別約為人民幣46.8百萬元、人民幣18.3百萬元、人民幣14.1百萬元及人民幣19.7百萬元，分別約佔我們採購總額的51.5%、35.1%、22.5%及28.6%。於往績記錄期間，我們的供應商一般授予我們0至90日的信用期。我們通過銀行轉賬或電子支付平台轉賬及支票向供應商支付採購價。

經作出合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，我們於往績記錄期間各年度／期間的五大供應商均為獨立第三方，且據董事所知，於最後實際可行日期擁有本公司已發行股本5%以上的董事、其緊密聯繫人或任何現有股東於往績記錄期間各年度／期間概無在我們的五大客戶中擁有任何權益。於往績記錄期間各年度／期間，我們的五大供應商均非我們的客戶。

業 務

下表根據往績記錄期間彼等向我們的採購情況，載列各年度／期間五大供應商的詳情：

截至2025年9月30日止九個月

排名	供應商	主要 採購產品／ 服務	與我們建立業 務關係 的年份	採購額 人民幣千元	佔期內 採購總額 的比例 %	信用期 天數
1.	供應商A ⁽¹⁾	晶圓	2020年	19,736	28.6	30
2.	供應商B ⁽⁸⁾	晶圓	2023年	6,454	9.4	0-30
3.	供應商C ⁽³⁾	封裝服務	2017年	5,072	7.4	30
4.	供應商E ⁽⁵⁾	封裝服務	2017年	4,103	6.0	60
5.	供應商F ⁽⁴⁾	晶圓	2020年	3,439	5.0	30

截至2024年12月31日止年度

排名	供應商	主要 採購產品／ 服務	與我們建立業 務關係 的年份	採購額 人民幣千元	佔期內 採購總額 的比例 %	信用期 天數
1.	供應商A ⁽¹⁾	晶圓	2020年	14,132	22.5	30
2.	供應商B ⁽⁸⁾	晶圓	2023年	6,486	10.4	0-30
3.	供應商C ⁽³⁾	封裝服務	2017年	5,706	9.1	30
4.	供應商E ⁽⁵⁾	封裝服務	2017年	4,097	6.6	60
5.	供應商F ⁽⁴⁾	晶圓	2020年	3,995	6.4	30

業 務

截至2023年12月31日止年度

排名	供應商	主要採購產品／服務	與我們建立業務關係的年份	採購額 人民幣千元	佔期內採購總額的比例 %	信用期 天數
1.	供應商A ⁽¹⁾	晶圓	2020年	18,306	35.1	30
2.	供應商C ⁽³⁾	封裝服務	2017年	4,300	8.3	30
3.	供應商D ⁽²⁾	晶圓	2018年	3,864	7.4	60
4.	供應商F ⁽⁴⁾	晶圓	2020年	3,201	6.1	30
5.	供應商E ⁽⁵⁾	封裝服務	2017年	2,478	4.8	60

截至2022年12月31日止年度

排名	供應商	主要採購產品／服務	與我們建立業務關係的年份	採購額 人民幣千元	佔期內採購總額的比例 %	信用期 天數
1.	供應商A ⁽¹⁾	晶圓	2020年	46,836	51.5	30
2.	供應商D ⁽²⁾	晶圓	2018年	8,424	9.3	60
3.	供應商G ⁽⁶⁾	封裝服務	2016年	4,283	4.7	60
4.	供應商C ⁽³⁾	封裝服務	2017年	3,936	4.3	30
5.	供應商H ⁽⁷⁾	晶圓	2019年	3,676	4.0	30

附註：

- (1) 供應商A由一個集團內的兩家公司組成，詳情如下：
 - (a) 一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事銷售半導體行業的功率器件及微型機電系統感應晶片。
 - (b) 一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事集成電路的製造及銷售。
- (2) 供應商D為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事供應鏈管理、購買及銷售電子產品及其他國內貿易、進出口業務及一般貨運。
- (3) 供應商C為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事半導體器件的供應，以及分立半導體器件及集成電路的生產及銷售。
- (4) 供應商F為一間於中國註冊成立的有限公司，已於2023年1月在深圳證券交易所上市，主要從事分立半導體器件的研發、生產及銷售。
- (5) 供應商E為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事分立半導體器件的生產及銷售，以及貨物及技術的進出口。

業 務

- (6) 供應商G為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事集成電路的生產及銷售。
- (7) 供應商H為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事半導體器件的研發、生產及銷售。
- (8) 供應商B為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事電子元件的設計、生產及銷售。

與供應商之合約的主要條款

一般而言，我們不會與供應商簽訂長期供應協議。下文概述與供應商簽訂之原材料(主要為晶圓)採購合約的主要條款：

合約價格及付款	產品應按合約所載協定單價出售。採購款項應在相關發票日期後0至60日內通過銀行轉賬或銀行匯票結算。
期限	單一採購訂單合約可臨時簽訂，如訂有框架協議，則通常為一至兩年的固定期限。
範圍	供應商應按照合約所載規定標準提供原材料。
供應商責任	原材料應符合合約所載協定質量標準。供應商應自費向我們交付原材料。
保修與賠償	對於有缺陷的產品，供應商通常須以同類原材料向我們提供賠償。
終止	臨時採購合約並未規定任何一方的終止權，而框架協議可能要求任何一方在發出合理通知後終止。
續期	臨時採購合約並未規定任何續期條款，而框架協議可每年自動續期

業 務

一般而言，我們與封裝廠供應商簽訂短期框架供應協議，並在框架期限內按需要向其提交採購訂單。下文概述我們與封裝供應商就產品封裝簽訂之框架協議的主要條款：

合約價格及付款	合約價格應基於供應商提交的最新產品封裝投標書。 封裝服務的付款應在相關發票日期後30至90日內通過銀行轉賬或銀行匯票結算。
期限	框架協議的有效期為一年
範圍	供應商應獲取並使用我們確認的原材料封裝我們的在產品
保密性	有關用於製造所需產品的技術、方法和工藝的技術文件及資料，以及我們的原材料和產品規格等專有資料，均歸我們所有，供應商須對其保密。供應商不得向他人披露該等資料。
監督權	我們有權監督和指導我們產品的製造標準和質量，並對供應商生產的產品樣品進行驗收確認。
產品合格率	根據我們最初提供予供應商封裝的在產品的數量，供應商所交付封裝產品須達到至少96%的合格率。

業 務

保修與賠償

如產品存在缺陷，雙方應共同找出缺陷的根本原因。如已確定根本原因並經雙方同意為供應商的過錯，則供應商應承擔責任，而我們有權就所遭受的損傷或損失向供應商索賠。此外，供應商應重新執行所需工作並重新封裝我們的產品，而不附加任何進一步的更改或條件。如已確定根本原因並經雙方同意為我們的過錯，供應商無須就我們所遭受的損傷或損失承擔責任。

如雙方未能就缺陷的根本原因達成一致，則任何一方均有權聘請具有國家認可測試資格的第三方對缺陷進行分析。上述第三方的分析為最終結果。

續期

如雙方無異議，框架協議在其初始期限屆滿後自動續期一年。

爭議解決

如雙方就框架協議的履行發生任何爭議，雙方應友好協商解決有關爭議。如無法達成決議，任何一方均可在中國提起訴訟。

銷售及營銷

我們採用直銷模式推廣我們的產品，其顯著增強了我們的競爭優勢。通過盡量減少分銷商的介入，我們與客戶建立密切關係，實現個性化互動及對客戶需求的更深入理解。透過直銷模式，我們的銷售及營銷部門能夠提供不僅滿足甚至超出客戶期望的定製產品，最終提升客戶滿意度及忠誠度。

業 務

發掘合適的潛在市場及客戶方面，朱先生領導的專責銷售及營銷部門至關重要。彼等積極參與展會，進行網絡搜索以及電訪獲取新客戶。該種積極的方法與制定及協調強調我們產品獨特特徵的營銷活動及促銷活動相輔相成。憑藉在功率半導體方面的廣泛知識及專業技能，我們的銷售及營銷部門可理解客戶需求並與研發部門合作提供技術支持。此舉確保我們能夠響應市場需求及技術進步，使我們能夠靈活調整產品。截至最後實際可行日期，我們的銷售及營銷部門由33名成員組成，彼等與其他部門密切合作執行我們的營銷策略。於2022財年、2023財年、2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們的銷售及分銷開支分別約為人民幣14.4百萬元、人民幣13.4百萬元、人民幣15.5百萬元、人民幣10.1百萬元及人民幣12.4百萬元，分別佔同期我們收益的約8.6%、11.9%、12.8%、12.3%及11.7%。

通過向客戶進行直銷，我們可避免與分銷商相關的成本，從而為客戶帶來更優惠的價格。該定價優勢不僅使我們的產品更加易於獲取，亦增強了我們的市場競爭優勢。此外，我們的不同之處在於我們能夠通過根據特定客戶需求定製產品設計，滿足各行各業的多樣化應用需求。該靈活性提高了我們產品的適切性，並可支持我們在定製化及直銷方面的雙軌並舉。

我們的方法不僅提高了我們產品的適用性，亦對我們的整體盈利能力作出了貢獻。通過提供定製化解決方案，我們能夠獲得更高的價格點並保持強勁的毛利率。此外，滿意的客戶往往會成為品牌擁躉，從而帶來寶貴的推介及不斷擴大的客戶群。因此，我們完全有能力把握半導體行業的新興機會，同時鞏固我們作為客戶可信賴合作夥伴的地位。

客戶

我們的五大客戶

下表載列往績記錄期間各年度／期間本公司五大客戶的若干詳情：

我們的客戶主要包括MOSFET的下游直接客戶。於往績記錄期間各年度／期間，本公司五大客戶貢獻的收益分別佔2022財年、2023財年、2024財年及截至2025年9月30日止九個月我們收益的約45.8%、31.7%、26.7%及29.4%。同期，於往績記錄期間各年度／期間我們向單一最大客戶的銷售額分別約為人民幣25.9百萬元、人民幣11.3百萬元、人民幣10.0百萬元及人民幣9.2百萬元，分別約佔我們收益的15.5%、10.0%、8.2%及8.7%。我們的董事認為，由於我們於相應時期擁有大量客戶，因此並未過度依賴任何單一客戶。於往績記錄期間，我們一般向客戶授出30至90日的信用期。客戶通過銀行轉賬或電子支付平台轉賬支付採購價。

業 務

經作出合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，我們於往績記錄期間各年度／期間的五大客戶均為獨立第三方，且據董事所知，於最後實際可行日期擁有本公司已發行股本5%以上的董事、其緊密聯繫人或任何現有股東於往績記錄期間各年度／期間概無在我們的五大客戶中擁有任何權益。於往績記錄期間各年度／期間，我們的五大客戶均非我們的供應商。

下表根據往績記錄期間向我們購買的情況，載列各年度／期間的五大客戶購買的詳情：

截至2025年9月30日止九個月

排名	客戶	與我們建立 業務關係 的年份	我們提供的 產品／服務	客戶的下游 應用	客戶下游產品	收益 人民幣千元	佔總收益 的比例 %	信用期 天
1.	客戶A ⁽¹⁾	2017年	MOSFET-SGT	消費電子	掃地機器人	9,197	8.7%	60
2.	客戶D ⁽⁴⁾	2018年	MOSFET-SGT	新能源及儲能	太陽能電池板、便攜式 儲能產品	6,905	6.6%	60
3.	客戶S ⁽¹⁰⁾	2021年	MOSFET-SGT及 溝槽	汽車電子、新能源 及儲能	充電器及開關	5,975	5.7%	60
4.	客戶P ⁽¹¹⁾	2022年	MOSFET-SGT、 超結及溝槽	消費電子	洗地機器人	4,436	4.2%	60
5.	客戶E ⁽⁵⁾	2019年	MOSFET-SGT、 超結及溝槽	消費電子、工業控 制	洗地機器人	4,360	4.2%	90

業 務

截至2024年12月31日止年度

排名	客戶	與我們建立 業務關係 的年份	我們提供的 產品/服務	客戶的下游 應用	客戶下游產品	收益 人民幣千元	佔總收益 的比例 %	信用期 天
1.	客戶A ⁽¹⁾	2017年	MOSFET-SGT	消費電子	掃地機器人	9,996	8.2	60
2.	客戶B ⁽²⁾	2018年	MOSFET-SGT	工業控制	電動工具總成、電動工 具智能控制器、電動工 具電機、電動工具電池 組、電動工具充電器、 家電智能控制器、家電 電機、家電電池組、鋰 電池儲能、光伏逆變器 及充電站	6,814	5.6	90
3.	客戶D ⁽³⁾	2018年	MOSFET-SGT	新能源及儲能	太陽能電池板、便攜式儲 能產品	5,835	4.8	60
4.	客戶C ⁽⁴⁾	2021年	MOSFET-超結	消費電子	洗地機、掃地機、割草機 及家用電器	5,191	4.3	60
5.	客戶E ⁽⁵⁾	2019年	MOSFET -溝槽	消費電子	掃地機器人	4,666	3.8	30

截至2023年12月31日止年度

排名	客戶	與我們建立 業務關係 的年份	我們提供的 產品/服務	客戶的下游 應用	客戶下游產品	收益 人民幣千元	佔總收益 的比例 %	信用期 天
1.	客戶F ⁽⁶⁾	2022年	MOSFET-SGT	消費電子	個人服務器電源	11,264	10.0	30
2.	客戶A ⁽⁴⁾	2017年	MOSFET-SGT	消費電子	掃地機器人	8,071	7.1	60
3.	客戶B ⁽²⁾	2018年	MOSFET-SGT及溝 槽	工業控制	電動工具總成、電動工 具智能控制器、電動工 具電機、電動工具電池 組、電動工具充電器、 家電智能控制器、家電 電機、家電電池組、鋰 電池儲能、光伏逆變器 及充電站	6,549	5.8	90
4.	客戶D ⁽³⁾	2018年	MOSFET-SGT	新能源及儲能	太陽能電池板、便攜式儲 能產品	5,929	5.2	60
5.	客戶G ⁽⁷⁾	2019年	MOSFET-SGT	消費電子	掃地機	4,066	3.6	60

業 務

截至2022年12月31日止年度

排名	客戶	與我們建立 業務關係 的年份	我們提供的 產品/服務	客戶的下游 應用	客戶下游產品	收益	佔總收益 的比例	信用期
						人民幣千元	%	天
1.	客戶H ⁽⁸⁾	2022年	MOSFET-SGT	消費電子	個人服務器電源	25,861	15.5	30
2.	客戶I ⁽⁹⁾	2020年	MOSFET-SGT	汽車電子	動力傳輸系統	16,512	9.9	60
3.	客戶F ⁽⁶⁾	2022年	MOSFET-SGT	消費電子	個人服務器電源	14,322	8.6	30
4.	客戶A ⁽¹⁾	2017年	MOSFET-SGT	消費電子	掃地機器人	11,159	6.7	60
5.	客戶D ⁽³⁾	2018年	MOSFET	新能源及儲能	太陽能電池板、便攜式儲能產品	8,696	5.2	60

附註：

- (1) 客戶A由兩家受上海證券交易所上市母公司共同控制的集團公司組成，具體如下：
 - (a) 一間於2006年在中國註冊成立的有限公司，總部位於蘇州，註冊資金為人民幣70.0百萬元。該公司主要從事電子設備的生產及銷售。
 - (b) 一間於2021年在中國註冊成立的有限公司，總部位於湖州，註冊資金為人民幣100.0百萬元。該公司主要從事鋰電池的設計、開發及生產。
- (2) 客戶B為一間於2011年在中國註冊成立的有限公司，為深圳證券交易所上市公司的附屬公司，業務運營規模約有1,400名員工，註冊資金為人民幣30.0百萬元。客戶B主要從事電腦及其他電子設備的製造。
- (3) 客戶D由受深圳證券交易所上市母公司共同控制的一家集團內的兩間公司組成，詳情如下：
 - (a) 一間於1996年在中國註冊成立的有限公司，總部位於深圳，註冊資金為人民幣30百萬元，截至2024年12月31日止年度，年營業額約為人民幣586.2百萬元。該公司主要從事國內商業、物料供銷、自營進出口業務及電腦軟件及電子產品的生產及開發。
 - (b) 一間於2022年在中國註冊成立的有限公司，總部位於湖州，註冊資金為人民幣50.0百萬元。該公司主要從事電子元器件、氣動及電動工具及智能電子設備等製造及批發業務。
- (4) 客戶C為一家於2011年在中國註冊成立的有限公司，總部位於深圳且已於2022年在深圳證券交易所上市，業務運營規模約1,500名員工，註冊資金為人民幣174.4百萬元，截至2024年12月31日止年度，年營業額約為人民幣36億元。客戶C主要從事便攜式儲能產品(核心產品)及太陽能板的銷售。
- (5) 客戶E為一家於2017年在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於蘇州，業務運營規模約35名員工，註冊資金為人民幣5.0百萬元。客戶E主要從事鋰電池系統及新能源領域的技術開發及服務。
- (6) 客戶F為一家於2017年在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於深圳，業務運營規模約為40名員工，註冊資金為人民幣208.4百萬元。客戶F主要從事集成電路晶片及半導體產品的設計、開發及銷售。

業 務

- (7) 客戶G是一家在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於蘇州，業務運營規模約50名員工，註冊資金為人民幣38百萬元。客戶G主要從事電子印刷電路板的開發、製造和銷售。
- (8) 客戶H為一間於2013年在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於深圳，註冊資金為人民幣153.8百萬元。客戶H主要從事開發超級計算晶片、硬件及軟件產品。
- (9) 客戶I由一家集團內的兩間公司組成，詳情如下：
- (a) 一間於2003年在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於深圳，業務運營規模約為30名員工，註冊資金為人民幣30.0百萬元。該公司主要從事電力機械及設備的製造。
- (b) 一間於2020年在中國註冊成立的私營有限公司，總部位於江西撫州，註冊資金為人民幣15.0百萬元。該公司主要從事獲許可的第二類醫療器械的生產，以及電子元器件的製造、批發及零售等。
- (10) 客戶S為於2007年6月在中國註冊成立的私營公司，總部位於廣東省惠州市，業務運營規模不足50名僱員及註冊資本為人民幣3.0百萬元。
- (11) 客戶P由兩間公司組成，包括(a)於2016年6月在中國註冊成立的一間私營公司，總部位於深圳，註冊資金為約人民幣42.67百萬元，主要從事人工智能機器人等的開發機銷售；及(ii)其於2022年9月在中國註冊成立的全資附屬公司，總部位於深圳，註冊資金為人民幣50.00百萬元，主要從事計算機軟件及人工智能等的開發。

與客戶之銷售合約的重要條款

一般而言，我們與客戶簽訂短期框架供應協議，彼等可於框架期限內按需要向我們提交產品採購訂單。下文概述我們與客戶就產品銷售簽訂之框架協議的主要條款：

合約價格及付款	合約價格應基於客戶向我們提交的獨立採購訂單及雙方協定的價格。 我們產品的付款應在相關發票日期起計30至90日內通過銀行轉賬或銀行匯票結算。
期限	通常為一至兩年的固定期限。
範圍	向客戶銷售我們的產品，並提供售後技術支持和諮詢服務。 我們通常需要承擔向客戶交付產品的費用和責任，包括保險費和物流費，以及運輸過程中產品的損壞。

業 務

保密性	各方通常須對另一方的技術、產品設計、商業計劃、客戶詳情及財務資料及文件和其他業務資料及其他專有資料保密，包括在銷售招標或談判過程中有關產品定價的詳情。
產品合格率	我們交付的產品批次通常需要達到較高的合格率，例如根據客戶訂購的數量，我們的產品合格率为97%或98%。
保修與賠償	<p>一般而言，我們的客戶須在收到我們產品後三日內以書面形式通知我們任何明顯的損壞或產品數量不匹配的情況，之後雙方將及時合作，了解問題原因，並採取措施解決問題。</p> <p>如我們的產品不符合預期規格，我們將在收到客戶報告後對產品進行內部評估。如內部評估確認產品不匹配或存在缺陷，我們的技術產品部門的品質控制團隊將通知銷售及營銷部門的客服團隊發起退貨請求，以完成退貨和換貨程序。</p>
續期	雙方可通過向另一方發出通知，同意經協商續期框架協議。
爭議解決	如雙方就框架協議的履行發生任何爭議，雙方應友好協商解決有關爭議。如無法達成決議，任何一方均可在中國提起訴訟。

銷售合約並未規定任何最低銷售承諾，亦未規定任何一方的終止權。當商品或服務的控制權轉移予客戶時，確認與客戶簽訂之合約的收益，其金額反映我們期望有權獲得以換取該等商品或服務的代價。

業 務

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們的董事確認(a)我們並未發生任何違反上述銷售合約的行為，可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響；及(b)除銷售合約、個別銷售訂單和其他銷售文件(包括送貨單、驗收報告和銀行入賬單)外，本集團與客戶之間並無附帶協議、安排、承諾或資金流動。

美國貿易政策及限制的變化

雖然美國政府近年對從中國進口的商品實施關稅及貿易限制，但該等貿易政策對本集團的影響並不重大，進一步詳情如下：

上游供應商

於往績記錄期間，我們的供應商主要位於中國。雖然我們產品的部分材料可能來自中國以外的上游供應商，但我們的上游供應商(主要包括第三方晶圓代工廠及封裝廠)均不位於美國市場或從美國市場獲取原材料。

下游客戶

於往績記錄期間，本集團幾乎所有收益均來自於中國的銷售。我們並無任何來自美國市場的直接客戶，亦不直接將產品銷售予美國客戶。然而，由於我們的客戶通常並非行業價值鏈中的最終消費者，彼等或會進一步將其產品(其整合我們的產品)售予更下游的客戶，從而可能涉及美國市場的消費者。有鑒於此，我們的產品或會間接售予美國市場的下游企業或分銷商，甚至終端客戶。

鑑於我們的客戶均非來自美國市場，我們通過考慮我們於往績記錄期間及截至2025年10月31日向面向美國市場的直接客戶的部分銷售額，估計美國貿易關稅或會對其業務的影響。為獲取此資料，我們已盡合理努力查詢其直接客戶的下游產品的指定市場，以估計其年度銷售額中可能面臨貿易限制及關稅風險的最大部分。

業 務

據董事所知、所悉及所信，我們獲悉，我們至少有一名客戶(即馬來西亞的客戶J)向美國客戶銷售其自有電子產品。2022財年、2023財年、2024財年及截至2025年9月30日止九個月，我們向客戶J的銷售額分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣2.4百萬元，分別佔同期收益的2.7%、2.4%、3.7%及2.3%，可能涉及該等風險(「已知風險敞口」)。雖然我們的若干其他客戶可能已在美國或向美國客戶銷售各自的下游產品，鑒於我們無法獲得有關各自客戶的下游產品已銷往美國市場或美國客戶的部分的信息，以及配備我們的產品的面向美國的下游產品的部分，我們無法準確確定其銷售中受影響的部分。鑑於我們一般不會與更下游的客戶有業務關係，亦對直接客戶的特定業務或銷售計劃無任何意向，我們通常並不具體了解配備我們自有產品的下游產品的目標客戶或市場。除所披露者外，我們的董事並不知悉任何主要客戶將其下游產品銷往美國或售予美國客戶。

鑑於對美國市場的已知風險敞口僅佔我們年度收益的一小部分，及本集團於營業記錄期間之後錄得強勁的業務增長，獨家保薦人同意董事的觀點，相信美國的貿易限制及關稅不會對我們的業務運營及財務狀況構成重大風險。

數據安全與隱私

在我們的業務過程中，我們收集、存儲和處理業務數據及交易數據。由於我們多數情況下僅與企業客戶進行交易，我們並不收集或處理個人數據。我們設有財務系統、人力資源管理系統及業務管理系統。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－安全漏洞及其他干擾可能會損害我們的機密及專有資料，這可能會對我們的業務及聲譽造成損害」及「監管概覽－有關網絡安全、數據保護的法律、法規」。

由於公司數據與相關信息的存儲及保護對我們至關重要，因此我們密切關注與我們IT系統有關的風險管理。為確保數據安全，我們採用嚴格的加密算法來存儲敏感數據，並嚴格執行數據訪問和傳輸政策，以確保我們數據的機密性。我們還制定了嚴格的內部控制和數據訪問機制，以及有關數據存儲和處理的詳細審批及操作程序。我們制定了一套關於數據安全的內部協議，其中就機密信息的使用、披露和保護，訂明詳細、嚴格的要求。此外，有關內部協議在有需要時向擔任特定職位的特定級別僱員提供有限的授權以訪問及處理公司數據，該等僱員僅為完成其工作任務而使用有關數據。

我們所有的僱員均須與我們簽署保密協議，該協議禁止彼等在未經我們的同意的情況下披露與其工作有關的任何機密信息。我們擁有全面的數據備份系統，可以在不同位置的服務器上加密及存儲數據，以最大限度地降低數據丟失的風險。我們亦定期進行數據恢復測試，檢查備份系統的狀態。

業 務

此外，我們通過在雲端、本地和遠程位置為相同的信息及數據設置多個長時間維度的存儲，為服務器建立了遠程容災系統。即使服務器因地震、泥石流及其他不可抗拒自然災害等最高級別災害而受損，我們相信其亦能保障和保證在24小時內完全恢復服務和數據。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無接獲任何第三方以侵犯任何適用法律法規所規定的資料保護權為理由而向我們提出的索償。中國法律顧問表示，我們的董事確認，我們在所有重要方面均遵守了有關個人信息隱私和數據安全的適用法律和法規。

存貨管理

我們的存貨包括原材料、在製品及製成品。請參閱「財務資料－綜合財務狀況表中若干選定項目的討論－存貨」。由於我們的銷售主要是根據客戶的特定需求提供定製化產品，因此我們一般預計客戶要求的訂單量，根據與彼等訂立的短期框架協議條款按需下單生產產品。生產產品需要相當長的交付週期，包括協調晶圓代工廠及封裝廠製造及完成產品質量檢查的時間，可能需要耗費大量時間方可完成，這意味着我們在客戶下訂單後開始向供應商下達指定產品的訂單，可能並非一直可行。因此，我們根據各自客戶分享的需求預測創建客戶需求預測，以確定其應為供應商預先儲備的產品數量，以滿足該等需求。本集團通常透過將客戶的預測分解為數月，以釐定其對供應商下達訂單的生產時間表。倘客戶的實際訂單顯著偏離客戶分解為數月的初步預測，本集團的市場及銷售部將與客戶確認，以了解是否需要調整預測。此慣例確保本集團於客戶下達訂單時能及時滿足客戶的需求，從而提高我們的服務質量及客戶滿意度。我們的製成品主要包括晶體管，原材料主要包括晶圓，而我們的在制品存貨主要包括代工製造的晶圓，由封裝廠進一步交付及加工。

業 務

我們已建立內部報送及審批程序，以優化我們產品的存貨管理的物流和採購訂單的標準。每件存貨入庫時均有一個獨特的識別碼。就此，我們可追蹤所有存貨的所有階段。我們確保存貨的合適儲存條件，以及從第三方供應商接收及向第三方供應商交付存貨的物流效率和準確性。此外，透過追蹤存貨，我們能夠透過執行以下程序有效管理存貨水平，以盡量減少減值虧損：(a)在出現重大偏差時調整客戶預測，以盡量減低訂單量不匹配的風險並降低庫存水平過高；及(b)跟進最初負責提供預測訂單量以訂購我們的產品的客戶；及(c)對於賬齡超過一年的製成品，我們(i)進行價格調整以售予客戶；(ii)優先將其交付予下游產品規格與該等製成品相匹配的其他客戶；及(iii)重新指定進行原型測試。

我們大約每個月根據產品型號抽查庫存，並不定期進行抽查，以確保倉庫運作順暢。在特別成立的工作小組領導下，我們的財務部門負責存貨核查與檢查，並將檢查結果與不足之處向高級管理階層報告。本公司董事確認，本公司的存貨控制系統及政策一直行之有效，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司並無出現任何重大供應短缺或存貨過剩的情況。

知識產權

我們認為專利、商標、商業秘密及其他知識產權對我們的業務運作至關重要。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有15項發明專利、5項實用新型專利、47項集成電路佈圖設計專有權、15項軟件版權及4項商標。我們並無在其他司法權區備案及獲授任何知識產權。有關本公司重要知識產權之資料詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—本公司業務的其他資料—本公司的知識產權」。

我們主要依靠綜合運用專利、商標、商業秘密及不正當競爭法以及合同權利(如保密協議)來保護我們的知識產權。我們通常在我們訂立的僱傭保密協議及部分商業協議中闡明與知識產權所有權及保護有關的所有權利及義務。此外，我們將採取以下關鍵措施來保護我們的知識產權：(i)實施一套全面的內部政策，建立健全的知識產權管理；(ii)部署專門的團隊來指導、管理、監督和監察我們知識產權方面的日常工作；(iii)及時註冊、備案和申請知識產權的所有權；(iv)積極跟蹤知識產權的註冊和授權狀態，倘發現與我們的知識產權有任何潛在衝突，及時採取行動；及(v)聘請專業的知識產權服務供應商。截至最後實際可行日期，我們在中國未曾發生任何因侵犯第三方知識產權而導致的重大糾紛或申索，且據董事及高級管理層所深知，彼等概不知悉任何該等糾紛。

業 務

競爭

我們在產品質量、滿足客戶期望的能力、經驗及聲譽方面面臨競爭。本行業的主要競爭因素通常包括產品穩定性及可靠性、價格競爭力、營銷及銷售能力以及品牌影響力。

我們認為，競爭對手進入有關MOSFET及IGBT的功率器件行業面臨較高的壁壘，其中包括高技術門檻、高資本投入及客戶認可壁壘等。鑒於MOSFET及IGBT產品的下游應用種類繁多，對性能和成本的要求各不相同，需要供應商掌握不同的功率半導體產品類型及其迭代，且產品所涉及的技术複雜程度較高，為後來的市場進入者設置了較高的壁壘，故此該等優勢與功率半導體行業相關。因此，持續創新並開發新技術和新產品以獲取新客戶和市場對我們而言至關重要。

儘管市場上較新的IGBT、SiC MOSFET及GaN MOSFET產品的技術先進，我們相信該等發展將對本集團專注傳統硅基MOSFET的長期影響有限。雖然IGBT更適合具有更極端參數的高壓、重載及高功率應用，但傳統MOSFET於低、中、高壓位準上用途更廣泛，惟存在高溫下洩漏及電阻增加等性能問題。因此，MOSFET因其緊湊的尺寸及低功耗而更適合電源及消費電子產品。此外，與更簡單、更經濟的傳統MOSFET相比，IGBT、SiC MOSFET及GaN MOSFET的生產更為複雜，成本更高。

由於我們的業務方針主要集中在提供定製產品解決方案，以滿足客戶特定應用場景或解決特定下游產品的缺陷或低效率，因此我們通過不斷擴展我們在IGBT、SiC MOSFET及GaN MOSFET的技術及開發能力，以及進一步增強現有產品的該等能力，與行業同行競爭，並尋找新客戶：

- 在劉鵬飛先生的指導下，本集團於2025年10月31日已進入新產品的多個開發階段，包括：(i)就本集團的新型IGBT設計而言，其晶圓的開發已進入試生產階段，我們處於落實若干設計規格過程中，預計於2026年第一季度開始原型測試，並於2026年上半年準備量產，用於其目標客戶的醫療設備；

業 務

- 此外，我們積極與東南亞及南亞的企業尋找新的商機。截至2025年10月31日，通過銷售代表的業務拓展努力，我們已與印度約16名客戶及越南約27名客戶建立業務關係，並取得進展，以及正在開發解決方案及原型，以與其下游產品進行測試，主要應用於新能源及儲能及消費電子應用領域等。根據我們過往幾個月的歷史業務發展成果，我們計劃繼續與該等地區的客戶建立新的業務關係，每月約兩至三名客戶。

有關我們行業競爭格局的更多資料，請參閱「行業概覽」。董事認為，我們能夠通過強化及發展我們的競爭優勢，維持對其他競爭對手的競爭力及我們的市場地位。本章節「一競爭優勢」一段重點列舉我們的競爭優勢。

僱員

截至最後實際可行日期，我們有68名全職僱員，彼等均於中國工作。下表載列按職能劃分的僱員人數：

職能	僱員人數 截至 最後實際 可行日期
高級管理層	3
研發	14
銷售及營銷	33
業務運營及行政	18
總計	68

我們認可人才對企業持續發展及最大化競爭優勢的重要性。我們相信成功取決於我們吸引、留住和激勵合資格人員的能力。我們採用多種招聘方式吸引人才和合資格人員，包括校園招聘、網絡及其他外部招聘渠道，以及內部推介、內部調動和來自供應商和客戶的外部推介。作為人力資源策略的一部分，我們為員工提供相對有競爭力的薪資、績效花紅及其他獎勵。我們通常會與我們的主要管理人員、銷售及營銷、研發與技術產品部等部門員工訂立保密協議，以保障自身利益。倘涉及任何競爭業務，我們可能會進一步與高級管理層或其他主要員工簽訂不競爭協議。我們參考(其中包括)員工達成或超越績效目標的程度，每年檢討彼等的績效。因此，我們一般能吸引並留住合資格員工，並維持穩定的核心管理團隊。

業 務

物業

我們的總部設在深圳，並在西安及蘇州設有若干運營職能。截至最後實際可行日期，我們在中國並未擁有任何物業，而在中國自第三方租賃四項物業，總建築面積約為1,941平方米。該等物業主要用作辦公場所、研發活動及倉庫。我們就上述租賃物業簽訂的租賃協議的租期通常介乎一至五年。

根據中國適用法律及法規，倘出租人未能提供租賃物業的業權文件、其他所有權證或相關機關批准建設該物業的許可文件，則無法確定租賃物業是否為已獲相關機關批准建設的樓宇，且相關租賃協議面臨被相關機關視為無效的風險。對於尚未獲得相關部門批准建設的租賃物業，存在相關部門責令拆除的風險，導致承租人無法繼續使用或從中受益。截至最後實際可行日期，我們尚未取得位於中國的四項租賃物業中兩項的業權文件，該等物業分別用作我們的辦公總部及倉儲設施。未能取得該兩項租賃物業的業權文件主要是由於以下原因：(1)就我們租賃的辦公總部而言，由於正在轉移物業所有權，故無法提供業權文件；及(2)就我們租賃的倉儲設施而言，業主未能提供業權文件。對於我們租賃的辦公總部，該物業由深圳市產業園區綜合服務中心(「服務中心」)管理，服務中心於2025年1月簽訂確認書，確認(i)其無法提供產權文件的原因及(ii)租賃的合法性。我們隨後就持續租賃辦公總部至2030年6月15日與服務中心訂立租賃協議。

根據中國適用法律及法規，物業租賃協議亦須向物業管理主管部門登記。我們的四項租賃物業的租賃協議亦未根據租賃登記規定向相關機關登記。截至最後實際可行日期，我們四項租賃物業各自的業主未能提供所需業權文件以完成登記。我們的若干租賃物業為商品房。根據相關中國法律及法規，我們可能會被相關政府部門勒令於規定期限內登記有關商品房的相關租賃協議，否則可能會就每份未登記商品房租賃被處以人民幣1,000元至人民幣10,000元不等的罰款。請參閱本文件「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們或會因未能登記及備案租賃協議而承擔責任，從而或會令我們受到處罰」。截至最後實際可行日期，我們並無接獲任何有關政府部門的有關要求或遭受任何有關罰款。

業 務

根據我們的中國法律顧問，相關部門因未能出示相關租賃物業的業權文件而對租賃物業發出拆除令的風險較低，且倘第三方主張其對租賃物業的權利並阻止我們使用租賃物業或從中受益，我們有權要求減免租金或拒絕支付租金。董事亦認為，未能完成該等租賃物業的備案不會對我們的業務營運或財務狀況造成任何重大或不利影響，是因為倘我們須終止租賃或遷離該等有業權瑕疵的租賃物業，我們將能夠於短期內根據可資比較條款搬遷至合適的其他物業，而不會產生重大額外成本。具體而言，搬遷本集團為持有我們的存貨而租賃的物業（「現有倉庫」）對我們截至2025年12月31日止年度的現金流的估計總影響將約為人民幣343,000元，主要歸因於替代物業（定義見下文）的翻新成本，而搬遷對我們截至2025年12月31日止年度的溢利的估計總影響將減少約人民幣214,000元，主要歸因於根據本集團將享有因搬遷而貼現的有關利益的可使用年期的估計剩餘期間撇銷對現有倉庫進行的翻新工程產生的經濟利益所致。因此，搬遷對本集團的財務影響並不重大。

此外，預計搬遷不會對我們的營運造成重大影響，因為(i)倉庫的替代場所預計與我們現有倉庫相距不遠，及(ii)不會影響我們的日常運營和研發活動。

根據我們的中國法律顧問，未能登記租賃物業的租賃協議並不影響租賃協議的有效性，亦不會對我們有關租賃物業的權利造成重大影響。為盡量減少未登記租賃對我們營運的潛在負面影響，我們已採取一切可行及合理的步驟，以確保該等租賃協議可向主管機關妥為登記，包括與相關出租人持續溝通，以尋求彼等合作以完成登記程序。

保險

於往績記錄期間，我們根據中國社會保險法規要求，為僱員繳納養老保險、失業保險、工傷保險及醫療保險等強制性社會保險。此外，我們投購汽車保險以涵蓋交通事故。截至最後實際可行日期，我們並未投購營運所需的保險。於往績記錄期間直至最後實際可行日期，我們並無遭受任何項目責任索賠。此外，我們的中國法律顧問表示，截至最後實際可行日期，本公司已為全體員工繳納社會保險及住房公積金，且並未收到相關監管機構的處罰或違規通知。董事認為，我們的整體保險政策與一般市場慣例一致，並符合中國相關規則及法規。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－對於我們可能面臨的責任或損失，我們的保險未必可全面覆蓋，因此，倘出現任何此類責任或損失，我們的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響」。截至最後實際可行日期，我們並未發生任何對我們業務產生重大不利影響的業務中斷。

業 務

獎項及表彰

下表載列往績記錄期間及截至最後實際可行日期我們獲得的部分獎項及表彰：

獎項／表彰	獲獎年份	頒獎機構
專精特新中小企業	2020年	深圳市中小企業服務局
專精特新「小巨人」企業	2024年	中華人民共和國工業和 信息化部

執照、許可及批准

截至最後實際可行日期，我們的中國法律顧問表示，我們已獲得在中國經營業務所需的所有重要執照及許可(即營業執照)，且該等營業執照仍全面有效。我們的中國法律顧問已告知我們，截至最後實際可行日期，營業執照續期方面並不存在重大法律障礙。

環境、社會及管治

我們認為，我們的持續增長取決於社會價值與我們業務的融合，且我們矢志成為負責任的企業公民。我們致力於推動企業社會責任及可持續發展，並將其融入我們業務運營的所有重要方面。我們亦致力於遵守中國的監管要求、遵守環境保護法律及法規並確保僱員的健康和安全。

我們的董事會監督關鍵的環境、社會及治理(ESG)風險，而在董事會辦公室及相關部門下運作的專門ESG工作組管理和執行我們的ESG策略。我們計劃為ESG工作組舉行年度會議，以推廣ESG舉措。該工作組不僅評估我們ESG策略實施的有效性，亦關注監管及行業趨勢以確保合規性。

我們為董事會成員、ESG工作組及各部門代表舉辦兩場專題ESG培訓課程。該等課程旨在提升整體持續發展意識，為有效落實ESG策略奠定堅實基礎。

業 務

持份者參與及重要性評估

於往績記錄期間，我們實施持份者參與及重要性評估，以識別與戰略發展密切相關的ESG議題。此評估有助於我們識別、評估及優先處理ESG議題，並深入理解持份者的期望。我們遵循以下流程：

1. ESG議題識別：為識別相關ESG議題，我們透過同業基準分析掌握產業趨勢，同時考量無晶圓廠商業模式、國家政策與法規。
2. 持份者參與：我們透過線上問卷進行持份者參與，以評估各項ESG議題的重要性，並收集內部及外部持份者的期望。此流程有助我們釐清ESG議題的優先順序。
3. 驗證程序：ESG工作組已審核並確認持份者參與及重要性評估的結果。

在上述評估中，風險管理、產品品質與研發創新被認為對營運具高度重要性。針對其他ESG議題，我們提供充分資料以確保可持續表現的透明度。

風險管理

我們的審計部門在確保內部控制和監管合規方面發揮著關鍵作用。其監督建立健全的內部控制體系，包括充足資源、合格人員以及足夠的風險管理培訓預算。我們認知到風險管理上的不足可能導致重大的財務或聲譽損害。為避免及減輕相關風險，審計部門會主動調查涉嫌欺詐、違反法規及控制失效的事件，並及時向董事會提供評估及建議。

研發創新

本公司深知持續研發創新對提供卓越產品與服務予客戶的重要性。我們深知創新進程的任何延遲都可能削弱市場競爭力與定位。為降低此風險，研發部門積極分析新技術、元件、工序及產品需求。此外，我們亦定期實施培訓計劃，確保員工掌握先進技術與產業趨勢，包括關鍵產品的工序引入與技術發展，例如MOSFET核心技術趨勢及IGBT應用。

業 務

產品質量

我們在產品開發過程中始終將安全置於首要位置。我們嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》，確保產品質量與企業社會責任。所有產品均依據相關標準進行可靠性測試，以確保其耐久性與穩定性。若任何產品未能符合該等標準，我們設有嚴格的程序處理不合格品類。此類產品將接受評估以釐清失效原因，我們將實施整改措施解決問題並防止再發生，確保僅有安全可靠的產品進入市場。

我們致力於提供優質產品並滿足客戶期望。由於產品設計與生產流程複雜，產品在首次推出或開始商業交付後可能存在未被發現的缺陷或故障，這可能需要進行產品更換或召回。此外，生產過程中使用的原材料變更亦可能導致產品失效。若我們的產品或產品集成導致系統故障，我們可能面臨產品責任索償。

為降低此類風險，我們依據中國內地ISO9001:2015標準建立質量管理體系，涵蓋產品設計、採購等營運環節，並具備顯著的產業資源優勢。此體系使我們能為客戶提供全面卓越的系統化解決方案，該等客戶通常對產品質量、性能及可靠性設有嚴苛規範，而我們的產品必須滿足其要求。

我們依據嚴格的篩選標準挑選供應商，以確保我們的需求可持續獲得滿足，並積極鼓勵供應商優化升級其生產流程與質量控制體系。所有交付產品均依照本公司質量管理標準進行嚴格檢驗。透過恪守質量控制標準，我們始終維持低產品退貨率。在整個往績記錄期間，我們的產品合格率達100%，超越90%的年度目標。產品合格率为我們的產品能够達到交付客戶所需產品質量的比例。

商業道德

我們對賄賂、腐敗和欺詐行為實行嚴格的零容忍政策，這體現在我們的協議和內部控制措施中。為增強組織透明度和誠信度，我們實施了有力的舉報機制，使員工和利益相關者能夠保密地舉報不當行為、不道德行為、金融欺詐或違規行為。該機制提供各種安全舉報渠道，包括面對面會議、專門熱線、電子郵件提交及匿名書面陳述。所有報告均會進行徹底調查，並採取嚴格的保密措施以保護舉報者免受報復。我們已實施多層監督機制，包括負責協助調查、向董事會報告調查結果並跟進糾正措施和改進工作的內部審計部門。在往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們的董事並不知悉本公司營運中發生任何重大賄賂及欺詐事件。

業 務

我們已推出結構化的誠信培訓計劃，旨在教育員工及主要利益相關者遵守合規標準、反賄賂法規及負責任的決策。該計劃採用多樣化的培訓方法，包括專家主導的研討會、案例研究、線上學習模組及互動討論，確保全面理解及實際應用。整個往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們已根據所有相關中國法律法規達成零重大不合規案件的年度目標，且未因不合規而受到任何罰款或處罰。

數據安全及知識產權保護

為保障資料安全及防止資料外泄，我們已實施嚴格的內部協議，為處理及儲存我們收集各類資料提供清晰指引。我們根據敏感級別對運營、業務及管理數據進行分類。對機密數據的訪問僅限於有明確訪問權限的特定員工。此外，我們已建立防火牆以保護核心數據，並在我們的運營中嚴格控制數字訪問。我們謹慎管理部門內的數據使用，而不會向外部各方披露任何保密資料。此外，我們亦有適當的安全措施防止員工濫用客戶數據。

為保護我們的知識產權，我們已實施全面措施。我們為僱員訂立包含保密、不競爭條款及知識產權所有權條款的僱傭協議。僱員必須同意，在受僱或參與期間創造的任何知識產權，包括我們內部開發的內容，均屬於本公司。

環境影響管理

由於我們經營無晶圓廠模式，且目前並無擁有製造設施或自建產能，因此我們並無面臨與健康、工作安全、社會或環境相關的重大風險。我們制定了《供應商行為準則》和《供應商環保規範》，以系統地監控和緩解供應商運營可能帶來的影響。我們要求供應商建立環境管理體系，促進能源和資源的高效利用，並在整個供應鏈中採用環保的設計和製造慣例。此外，彼等須遵守有關污染物的相關法規，包括廢水、廢氣排放和固體廢物，確保從生產到處置的整個過程都得到負責任的管理。我們的供應商有合同義務確保原材料及組件符合基本的安全、健康、質量及環境標準。該等標準包括但不限於電氣及電子設備的有害物質限制(RoHS)法規以及REACH框架下的化學品使用限制。

於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，並沒有重大環境或營運事故發生。我們已經策略性地制定採購管理協議，描述包括協商、交付、驗收及付款在內的綜合流程。環境保護及可持續發展原則被系統地納入供應商資格標準，營運部門的採購團隊獲授權在選擇及評估供應商時優先考慮該等因素。

業 務

未來，我們的目標是通過加強環境保護要求、要求供應商遵守國際認可標準，如《負責任商業聯盟行為準則》以及在供應商合同中加入相關條款，進一步拓展我們在價值鏈中的環境承諾。

作為技術創新者及設計者，我們不斷倡導可持續實踐，以減少自身運營中對環境的影響。我們將制定一套系統方法以促進節能及減少資源消耗。

我們在所有主要營運場所都張貼顯眼的環保原則、減少用水量及無紙化主張標誌。我們亦系統地部署數字化營運架構和雲端服務架構，以減少所有營運場所的紙張消耗。我們亦在營運中提倡廢棄物管理的最佳作法。在我們的主要營運場所，我們推出了廢物管理和分類指引，以提高員工對適當處理程序的認知及了解。

為降低電力消耗，我們已實施具體的可持續發展措施。設施主管須定期執行建築物巡查，並在無人使用的區域啟用自動化照明管理系統。我們系統性地鼓勵員工建立非工作時段的電腦關機規範。該等綜合措施有助我們降低能源依賴度，並透過減少碳排放來降低對環境的負面影響。

根據持份者參與及重要性評估結果，環境議題未被列為我們的關鍵議題。因此，我們將優先處理對戰略發展更具重要性的社會與治理議題。我們持續致力監測自身營運及供應鏈的環境表現，並計劃未來制定範圍三減排目標。

業 務

截至2022年、2023年及2024年12月31日的溫室氣體排放量、能源消耗量與用水量數據如下：

內容	單位	2022年	2023年	2024年
溫室氣體排放				
溫室氣體總排放量	二氧化碳當量噸	93.09	105.50	118.27
直接溫室氣體排放(範圍1) ¹	二氧化碳當量噸	36.77	45.65	35.45
間接溫室氣體排放(範圍2) ²	二氧化碳當量噸	52.77	59.85	64.93
間接溫室氣體排放(範圍3) ^{3、4}	二氧化碳當量噸	3.55	13.41	17.89
能源消耗				
電力	千瓦時	98,347	111,529	121,003
用水量				
用水量 ⁴	立方米	270	342.1	79.2

我們的目標是透過在環境影響管理領域建立和實施更多與可持續發展一致的內部政策，進一步減少營運過程中的碳排放和資源消耗。

人才管理與發展

我們致力於建立以技術創新和有效服務為基礎的合作文化。該文化不僅強調團隊合作的重要性，亦重視每位成員的獨特貢獻。我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》和《中華人民共和國勞動合同法》，確保員工的基本權利和合法權益得到充分保障。我們堅信多樣性和包容性是企業成功的基礎，我們承諾提供平等的就業機會。我們明確反對各種形式的歧視，包括基於種族、膚色、信仰、宗教、性別、性取向的歧視。我們不容忍童工，並嚴禁強迫或非自願勞動。我們的目標是營造一個安全、健康、互相尊重、互相支持的工作環境，讓每個人都能感受到歸屬感，並擁有成長的機會。

¹ 直接溫室氣體排放指燃料消耗所產生的排放，包括柴油和汽油。

² 間接溫室氣體排放(範圍2)包括外購電力消耗所產生的排放。

³ 根據現有資料，我們計算了因商務航空旅行產生的間接溫室氣體排放量(範圍3)。未來，我們將擴大溫室氣體排放數據收集的範圍，並披露其他範圍3類別的數據。

⁴ 我們於2024財年優化了ESG相關指標的數據收集流程，使範圍3間接溫室氣體排放量及用水量的報告數據更為精確。

業 務

截至2024年12月31日，本公司員工按性別及年齡層劃分的人數如下：

項目	單位	2024年
總數	人數	66
按性別劃分		
男性	人數	33
女性	人數	33
按年齡層劃分		
30歲以下	人數	20
30歲至未滿50歲	人數	45
50歲及以上	人數	1

為確保招聘過程的公平性和透明度，我們設有一套系統化的招聘管理方法。該方法明確規定了整個招聘過程的標準和要求，旨在吸引最合適的人選加入我們的團隊。同時，我們建立了統一的薪酬管理體系，客觀公正地評估員工績效，以確定其薪酬和晉升機會。在該制度下，所有有關薪酬調整和職業發展的決定均基於員工的專業能力、工作表現和對本公司的貢獻，而非與工作無關的個人特質。除了完善的福利制度外，我們亦鼓勵員工保持健康的工作與生活平衡。

我們意識到員工成長對公司長期發展的重要性，根據員工的職業階段提供各種培訓機會，包括一般培訓(涵蓋企業文化、員工權利及責任、工作場所安全及數據安全)及專項培訓，以幫助員工發展個人技能。為支持員工的持續成長，我們訂立了員工年度培訓參與率達到100%的目標。於2024年，我們為研發部門及其他部門的員工組織多次專業培訓課程。該等培訓課程不僅提高了彼等的專業技能，亦促進了跨部門的溝通與合作，從而增強了團隊凝聚力。我們認為投資於員工的成長就是投資於公司的未來。透過提供資源及支持，我們旨在讓每一位員工均能在職業生涯中取得卓越成就，同時為公司發展不斷注入新的活力。

業 務

健康及安全

為確保員工的職業安全，我們遵守《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國安全生產法》及《工傷保險條例》。我們已依據GB/T45001-2020 訂立安全作業政策。我們亦實施內部規定，要求所有員工簽署安全責任承諾書，並定期參加職業安全培訓。此外，我們制定了綜合應急預案體系，包括應急手冊、職業危害應急救援計劃、消防安全規定、危害識別、化學危害管理程序及準備和響應程序，有效處理潛在事故。我們已制定職業健康與安全目標，致力實現年度零健康與安全事故。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，並無發生與我們產品或服務的安全性或可靠性相關的重大負面事件。本集團持續全面遵守所有適用的環境、健康及工作安全法律及法規，且未因違規行為而面臨任何罰款或處罰。

法律程序及合規

據董事所深知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾且並未捲入任何重大法律、仲裁或行政程序，亦不知悉任何針對我們或董事的未決或構成威脅的法律、仲裁或行政程序，而本公司董事認為其可能對本公司的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。據董事所深知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的業務運營在所有重大方面均按照適用法律及法規開展。

風險管理及內部控制

董事會負責確保我們維持健全有效的內部控制及風險管理系統，從而始終保障股東的投資及我們的資產。我們訂有內部手冊，當中載列運營流程、內部控制程序及其他政策指引。我們已在業務運營的各個方面(如財務報告及合規)採用及實施全面的風險管理政策。

董事會及總經理負責建立、更新及實施我們的內部控制政策及系統，而我們的管理團隊監督與我們職能團隊有關的內部控制程序及措施的日常執行情況。

業 務

為籌備[編纂]，本集團已於2024年12月委聘獨立第三方顧問(「**內部控制顧問**」)對財務報告內部控制的選定範疇進行審閱。內部控制顧問進行審閱的範圍由我們、獨家保薦人及內部控制顧問協定，涵蓋企業層面監控、財務報告及披露監控及業務流程層面監控，包括監控環境、風險評估、報告及披露、收入及應收賬款、採購及應付賬款、人力資源及薪酬、財資管理、保險、關聯方交易，以及研發、商標及知識產權。於審閱期間，發現若干內部控制事宜，而內部控制顧問已進行跟進審閱，以檢討本集團為處理該等發現而採取的管理行動的狀況。內部控制顧問於跟進審閱後並無提出任何進一步建議。初步審閱及跟進審閱乃根據本集團提供之資料進行，內部控制顧問並無就內部控制作出任何保證或意見。

為於[編纂]後持續監控我們的風險管理政策和企業管治措施的實施情況，我們已採取或將繼續採取(其中包括)下列措施：

- 採納各種政策以確保遵守上市規則，包括但不限於與風險管理、關連交易及信息披露相關的方面；
- 投購適當的董事及高級職員責任保險，以應付針對本集團董事及高級職員的任何潛在法律訴訟；
- 維持及更新關聯方名單，以追蹤本集團所有相關人士及每項關連交易的上限，並每年審閱名單，以作出適當披露；及
- 採納本集團內有關內幕交易、舉報不當行為、獨立性及利益衝突、反洗錢、舉報及反欺詐措施的各項政策及程序。

基於以上所述，董事認為我們已採取合理步驟建立足夠及有效的內部控制系統和程序，以管理本公司在業務營運中面對的風險。

財務報告風險管理

我們已制定一套與財務報告風險管理相關的會計政策，並已設立多項程序以實施會計政策，我們的財務團隊根據該等程序審閱我們的管理賬目。我們亦為財務部門成員提供定期培訓，以確保其了解我們的財務管理及會計政策，並在日常運營中貫徹執行。

業 務

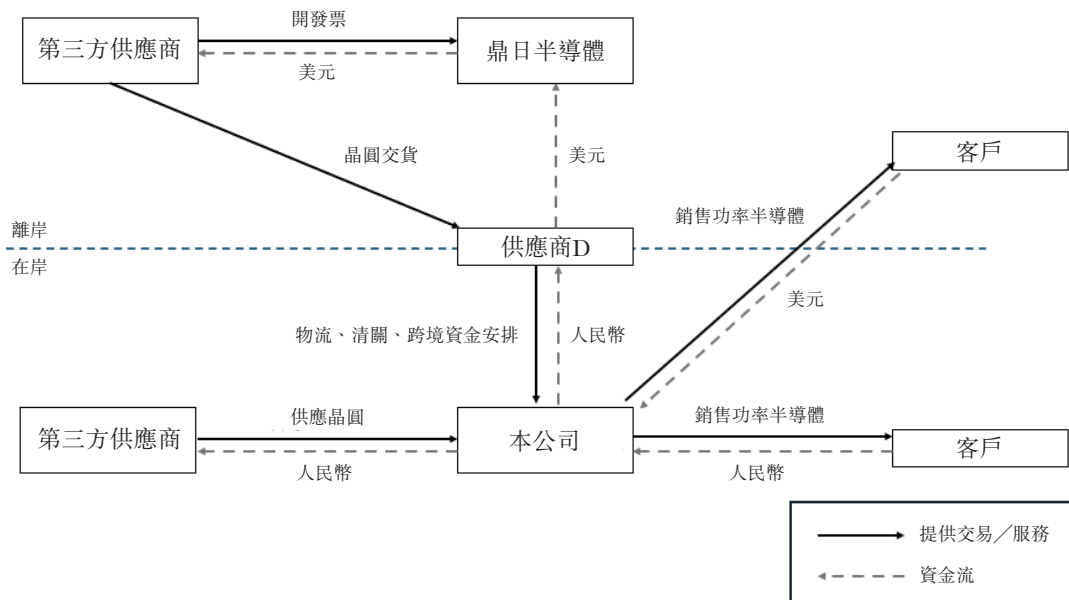
合規風險管理

為有效管理我們的合規及法律風險敞口，我們已採用嚴格的內部程序，以確保我們的業務運營符合適用規章制度。根據該等程序，我們內部法務團隊履行審核及更新我們與客戶、合作夥伴及供應商簽訂的合約形式的基本職能。在我們訂立任何合約或業務安排之前，我們的綜合管理部門的法務團隊會檢查合同條款並審閱業務運營的所有相關文件，包括交易對手為履行其業務合約義務所取得的牌照及許可，以及所有必要的相關盡職調查材料。

我們的內部法務團隊負責獲得任何必要的政府預先批准或同意，包括在規定的監管期限內編製及提交所有必要文件，以向相關政府部門備案。我們根據法律、法規及行業標準的變化，不斷完善內部政策，並更新法律文件的內部模板。我們對我們的運營及僱員活動的各個方面進行合規管理。我們亦已就僱員違反法律、法規及內部政策建立一套問責制度。此外，我們持續審核風險管理政策及措施的實施情況，以確保我們的政策及實施有效且充分。

轉讓定價協議

於2022年，我們成立了鼎日半導體，旨在銷售我們的MOSFET產品及在海外採購原材料。於往績記錄期間，鼎日半導體主要作為本公司的海外採購部門，我們透過鼎日半導體向主要位於台灣的供應商採購晶圓以生產MOSFET。下圖說明本集團於往績記錄期間及截至最後實際可行日期的原材料交易流程：



業 務

在涉及從海外採購晶圓的典型交易中，鼎日半導體直接向海外供應商發出採購訂單。由於我們通常委託供應商D處理物流、清關及存儲相關事宜，因此生產完成後，我們再指示海外供應商將晶圓運至供應商D在香港的倉庫。原物料再由供應商D運至本公司指定地點，晶圓再由我們指定之封裝廠進一步加工，所生產之MOSFET隨後銷售予客戶。考慮到本集團並非專門從事國際貿易及供應鏈管理，且不方便與其海外供應商頻繁兌換外幣及進行跨境結算，董事認為讓第三方供應商(如供應商D)提供該等服務屬合理及業務規範，因此認為該等貿易安排完全符合所有適用規則及法規。此外，香港法律並未限制第三方進行此類貿易安排以購買半導體產品或參與結算過程。

資金流方面，除清關及物流服務外，本公司亦委聘供應商D作為外匯結算中介人，以結算本公司與鼎日半導體之間的款項。供應商D向本公司開具增值稅發票，金額包括進口貨物價格(含鼎日半導體加價部分)、關稅、增值稅、消費稅及供應商D收取的服務費等，本公司再以人民幣結算。與此同時，供應商D將以美元向鼎日半導體結算，而鼎日半導體再根據所提供的信用條款與海外供應商結算交易金額。

如上文所述，鼎日半導體供應晶圓供本公司加工及銷售被視為集團內關聯方交易(「轉讓定價安排」)。我們委聘獨立轉讓定價顧問安永(中國)企業諮詢有限公司(「獨立轉讓定價顧問」，其為在中國的一家國際專業會計公司)對2024財年的上述交易進行轉讓定價研究，並已計及香港和中國的轉讓定價適用規則和法規。分析結果顯示，雖然該等公司間交易未必完全按公平原則進行，但2024財年的低交易量不會對本公司造成任何重大影響。於2024財年及截至2025年9月30日止九個月的最高稅項影響(假設鼎日半導體並無極端佔用任何毛利率)估計分別約為人民幣45,000元及人民幣22,000元。此外，根據往績記錄期間的轉讓定價安排，分配予鼎日半導體的利潤高於獨立方通常可獲得的利潤，獨立轉讓定價顧問認為，就香港稅務而言，轉讓定價安排並無賦予鼎日半導體任何潛在優勢。獨立轉讓定價顧問進一步認為，稅務局進行轉讓定價調整而增加鼎日半導體利得稅負擔的風險較低。另一方面，於往績記錄期間，透過轉讓定價安排，鼎日半導體獲分配更多利潤，高於獨立方通常可賺取的利潤，中國內地稅務機關可能認為該交易導致中國內地所得稅減少，從而對該交易實施轉讓定價調整。

業 務

轉讓定價安排並無違反任何香港法律，本公司於2024財年及截至2025年9月30日止九個月就轉讓定價安排所涉及的稅務風險最高估計分別約為人民幣45,000元及人民幣22,000元，金額相對較小，且控股股東劉先生已根據中國適用法律法規要求，就本集團任何成員公司於往績記錄期間因任何合規事件可能蒙受的損失，向本公司簽訂賠償契據，故該轉讓定價風險不會對本公司正常生產經營構成重大法律障礙。

展望未來，董事將根據鼎日半導體的擴充及發展情況，徵詢獨立轉讓定價顧問意見以取得合適的毛利率，並定期就即將實施的轉讓定價安排進行基準評估。截至最後實際可行日期，就董事所知，香港或中國任何稅務機關並無就我們的轉讓定價安排作出任何查詢、審核或調查。該等集團內交易於2022財年、2023財年及2024年財年以及截至2025年9月30日止九個月的金額分別為零、零、約人民幣3.5百萬元及約人民幣4.5百萬元。鼎日半導體於2024財年就本公司的集團內交易錄得的毛利率為24.4%，乃董事經考慮以下因素後釐定(i)本集團向客戶收取的整體毛利率約為56.9%；(ii)保留鼎日半導體的合理利潤作為其營運資金，尤其是本公司準備在香港設立辦事處，並已於截至最後實際可行日期招聘三名當地員工；及(iii)逐步承擔第三方供應商的海外採購角色。經考慮(i)轉讓定價安排的理由，即我們擬保留鼎日半導體的合理溢利作為其於香港設立辦事處以逐步承擔海外採購角色的營運資金；及(ii)於往績記錄期間的低交易量並無對我們造成任何重大影響，本公司董事並不知悉轉讓定價安排會對自身內部管理及／或財務報告制度造成重大影響。儘管如此，根據專業人士(尤其是獨立轉讓定價顧問)的意見，我們已採取以下整改措施以加強轉讓定價合規及內部監控：

- **獨立轉讓定價政策審查：**委聘獨立轉讓定價顧問針對關聯方交易進行轉讓定價研究。
- **轉讓定價政策實施：**(a)修訂轉讓定價政策以符合當地轉讓定價法規及《經合組織轉讓定價指南》；及(b)定期審查轉讓定價政策並更新轉讓定價研究，確保未來轉讓定價管理的有效性。
- **鼎日半導體利潤水平監控：**依據轉讓定價顧問最新基準研究，持續監控鼎日半導體2025年及後續年度利潤水平，確保完全符合當地轉讓定價法規及《經合組織轉讓定價指南》所載之公平原則。

基於上文所述，獨立轉讓定價顧問、內部控制顧問及獨家保薦人認為，上述措施可協助本公司透過即時實施符合當地轉讓定價法規及《經合組織轉讓定價指南》的政策及定期監察相關實體的溢利水平，有效管理其轉讓定價。